

業 務

概覽

我們成立於二零零五年，為一家領先的托盤及托盤相關產品的後段半導體傳輸介質製造商，於往績記錄期間，我們的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。除專注於托盤及托盤相關產品的設計、開發、製造及銷售，我們亦自二零一九年起將載帶納入我們的產品類別。除後段半導體傳輸介質外，我們亦提供MEMS及傳感器封裝解決方案。根據F&S報告，截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，後段半導體運輸介質行業中托盤及托盤相關產品的市場佔有率分別為31.7%及31.3%。於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中，我們於二零二一年排名全球第三，市場份額約為9.4%。

我們的後段半導體傳輸媒體產品(即托盤及載帶)主要用於半導體器件的保護，包括功率分立半導體器件、光電、集成電路及傳感器等。我們的托盤及載帶於托盤或膠帶錶面專為容納、安全處理、運輸及存儲不同半導體器件而設計，包括功率分立半導體器件、光電器件、IC及傳感器，具有ESD保護及高耐熱性。我們的MEMS及傳感器封裝解決方案提供一個外殼，旨在促進向電子設備的電路板傳遞信號的電觸點，並保護MEMS及傳感器免受潛在的外部元件損壞及老化的腐蝕影響。於研發及材料工程部及銷售和市場推廣人員以及可定制的製造平台及設計支持服務的支持下，我們能夠滿足客戶的各種特定要求，並簡化及時完成於條款上優化的複雜設計成本及性能。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已開發超過1,400種不同尺寸的多元化產品規格，具有不同的熱、機械及物理性能指標，滿足客戶的規格及所需的質量標準。

我們於中國東莞設立兩個生產廠房。於最後實際可行日期，我們擁有四個生產設施，其中兩個負責製造托盤及托盤相關產品，其餘各負責生產載帶及MEMS及傳感器封裝解決方案。根據F&S報告，後段半導體傳輸介質行業的全球市場規模將由二零二二年的約948.3百萬美元以7.2%的複合年增長率增長至約二零二六年的約13億美元，而全球MEMS及傳感器封裝行業市場規模將由二零二二年的約58億美元增長至二零二六年的約74億美元，複合年增長率為6.0%。為把握後段半導體傳輸介質行業和MEMS及傳感器封裝解決方案行業的市場增長，我們計劃通過升級我們於中國的生產設施(特別是購買自動化機器及於菲律賓開始生產載帶)。

經過超過15年的發展，我們已建立廣泛的客戶群，包括若干國際IDM公司、無晶圓廠半導體公司及IC封裝測試機構，例如STMicroelectronics。根據F&S報告，就IDM公司而言，其各自完成包括設計、製造、組裝、測試及封裝在內的全部或大部分生產階段，而IDM的若干生產程序亦可能分包予其他合約製造商。IDM模式透過零售整合產生效率。就無晶圓廠半導體公司而言，生產分為(i)設計；(ii) IC/晶圓製造；及(iii) IC組裝、封裝和測試。根據F&S報告，無晶圓廠模型透過界定工作及專門化產生效率。截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們約27.3%的收入

業 務

來自中國的客戶。為貼近客戶，我們於香港設立總部，並於香港、東莞、中國及新加坡設有三個銷售辦公室以及於全球設有八個銷售點，其中我們聘請銷售代表，分別位於(i)中國上海，(ii)台灣臺北，(iii)台灣高雄，(iv)韓國首爾，(v)馬來西亞馬六甲，(vi)歐洲意大利，(vii)美國亞利桑那州及(viii)菲律賓。由於我們已於全球發展後段半導體傳輸介質行業的既定客戶。我們打算繼續與我們的全球客戶密切合作，並利用我們的規模及技術領先地位，進一步抓住快速發展的半導體行業的機遇(尤其是於中國)。

我們的收益由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約166.0百萬港元增加約22.3%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約202.9百萬港元，並由截至二零二一年六月三十日止六個月的約91.6百萬港元增加約31.6%至截至二零二二年六月三十日止六個月的約120.5百萬港元，其中大部分收益來自銷售托盤及托盤相關產品，其中分別佔我們截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年及二零二二年六月三十日上六個月的總收入約94.8%、96.3%、96.5%及97.2%。我們的純利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約12.4百萬港元增加約112.8%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約26.4百萬港元，並因[編纂]約9.0百萬港元的影響由截至二零二一年六月三十日止六個月的約8.6百萬港元減少約54.5%至截至二零二二年六月三十日止六個月的約3.9百萬港元。

競爭優勢

多年來，我們的規模、市場份額及財務業績一直增長，我們相信以下競爭優勢有助於我們取得成功：

我們的業務由半導體行業驅動，將受益於快速增長的全球半導體行業

我們的半導體傳輸媒體產品(即JEDEC托盤及載帶)，對半導體器件製造過程的不同階段至關重要。因此，我們的客戶主要來自半導體行業，我們的業務亦受到半導體行業的高度推動。根據F&S報告，後段半導體運輸介質作為半導體器件於運輸過程中必不可少的補充密封產品，特別是當半導體終端產品及子組件經常沿著供應鏈進行區域及全球運輸時，鑑於近年來對快速周轉的需求激增，後段半導體應不斷受到半導體行業強勁增長的推動。此外，對後段半導體傳輸介質的需求亦高度依賴於品牌商及終端客戶對電子產品的下游需求，該等產品均嵌入集成電路和芯片。於技術創新的推動下，各種電子產品如手機、

業 務

筆記本、電信服務器、汽車、智能家居及智能可穿戴設備的需求得到推動。於各種應用環境中，電子設備的滲透率及數字化程度不斷提高，加上5G網絡及物聯網等技術的興起，產品的更新換代週期很強，刺激對半導體產品的需求，從而刺激對後段半導體傳輸介質的需求。

根據F&S報告，按銷售價值計算，全球半導體行業的市場規模由二零一六年至二零二一年以10.4%的複合年增長率增長，預計將以9.9%的複合年增長率由二零二二年的6,178億美元增長至二零二六年的9,007億美元，其中根據F&S報告，中國的半導體行業預計將超越其他市場。近年來，越來越多公司承擔IC晶圓製造商、IC組裝及封裝測試的角色，歸功於中國政府實施的支持半導體產業的政策。於二零二一年，中國已佔全球半導體行業市場份額的33.7%，預計二零二二年中國的市場份額將增加至33.9%。

根據F&S報告，於二零二一年，我們於後段半導體傳輸介質行業的所有托盤及托盤相關產品製造商中全球排名第三。我們記錄的收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度的166.0百萬港元增長至截至二零二一年十二月三十一日止年度的202.9百萬港元。特別是，截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們錄得來自中國客戶的收入分別為32.9百萬港元及55.5百萬港元，或約佔我們總收入的19.8%及27.3%。

作為後段半導體傳輸介質行業的領導者，於二零零五年成立優博企業後，於業務初期，主要承擔銷售與營銷、產品設計與開發、模具設計、管理與製造以及材料工程，同時將產品製造委託予其他OEM工廠。於二零零六年，我們與三個主要客戶建立業務關係。鑑於我們的托盤及托盤相關產品的銷量持續增加，我們於二零一零年在中國廣東省東莞市沙田開始運營第一間生產廠房。於二零二一年，我們亦於中國廣東省東莞市厚街開始運營第二間家生產廠房。憑藉我們位於東莞的生產基地以及我們廣泛的銷售辦事處及銷售點，我們能與國際IDM公司、無晶圓廠半導體公司以及IC組裝及封裝測試廠建立並維持長期合作關係。我們位於東莞的生產基地亦為抓住中國半導體行業預期持續增長的平台。我們相信，我們在生產方面的靈活性及能力將使我們能夠從加速的市場趨勢中抓住機遇，並更好地為我們於中國或海外市場的現有及潛在客戶提供服務。多年來，我們持續投資於產品中應用先進材料的生產技術及提高生產效率，以進一步鞏固我們於後段半導體傳輸介質以及MEMS及傳感器封裝解決方案服務行業的地位。憑藉我們於後段半導體傳輸介質行業的既定地位，由於我們的業務乃由半導體行業驅動，我們相信我們將自快速增長的半導體行業中受益。

業 務

我們於後段半導體傳輸介質行業的穩固地位使我們能夠於中國及海外市場快速增長的半導體行業中進一步尋求載帶及其他新產品的銷售機會

由於我們為後段半導體傳輸介質行業的全球托盤及托盤相關產品製造商的市場領導者之一，我們為全球後段半導體傳輸介質產品建立龐大的客戶群。於往績記錄期間，我們的收入主要來自銷售托盤及托盤相關產品，而載帶自二零一九年起已納入我們的產品類別。於當今的許多行業及應用中，捲帶包裝解決方案亦已成為半導體器件的重要封裝方法。托盤用於容納尺寸中及大尺寸的半導體器件，捲帶包裝解決方案則可於相對較小尺寸內容納更多半導體器件，可大大減少製造過程中的組裝停機時間，且通常用於將元件送入自動貼裝機，以便於板組件上進行表面安裝。此外，半導體器件的封裝方法已向小型化及更高的最終產品效率發展。採用協議代碼的最新封裝方法設計（即QFN樣式、DFN及WLCSP）為快速增長的細分市場，利用表面貼裝及晶圓級技術簡化製造工藝，並越來越多應用於不同類型的電子產品，如電動汽車、消費電子產品及醫療設備。由於載帶及捲盤配置通常用於將元件送入自動貼裝機以進行表面貼裝於板組件上，長遠而言，表面貼裝封裝方法的不斷進步將推動對載帶和捲盤的需求。根據F&S報告，全球後段半導體傳輸介質行業預計將由二零二二年的948.3百萬美元增至二零二六年的13億美元，複合年增長率為7.2%。特別是全球載帶及捲盤市場預計將由二零二二年的629.2百萬美元增長至二零二六年的862.4百萬美元，複合年增長率為8.2%。

根據F&S報告，下遊客戶（如IDM公司及無晶圓廠半導體公司）於整個生產過程中使用托盤及托盤相關產品以及載帶作為後段半導體傳輸介質。憑藉我們超過15年的經營歷史，我們已於全球後段半導體傳輸介質行業建立固定客戶群。於往績記錄期間，我們為超過100家客戶的後段半導體傳輸介質供應商。於二零二一年，我們的產品配送至250多個配送點。我們相信，我們與客戶建立的廣泛而穩固的關係使我們能夠抓住現有客戶對載帶產品的市場需求。鑑於載帶及捲軸市場的發展，並利用我們於後段半導體傳輸介質行業的既定客戶，我們打算於中國及海外市場快速增長的半導體行業下尋求銷售載帶的機會，因此，我們於二零一八年建立自動化生產設施，試生產載帶。作為全球後段半導體傳輸介質

業 務

行業的成熟企業，以及市場上使用捲帶式包裝解決方案的新興增長趨勢，我們亦因此處於有利地位，以抓住不斷增長的載體，通過利用我們於提供後段半導體傳輸介質的既定地位以及我們與半導體製造商現有的穩固關係，我們於全球載帶及捲盤市場上取得成功。

具有研發及產品開發能力的垂直整合業務模式以及自營生產廠房使我們能夠為客戶提供全面的產品組合

作為半導體行業的市場參與者，我們採用垂直整合業務模式以控制我們的主要業務營運，涉及後段半導體傳輸介質的設計、開發、製造及銷售以及提供MEMS及傳感器封裝解決方案。本集團具備執行研發、製造及銷售等所有步驟的能力，於中國廣東省東莞市經營我們的生產廠房，無需將任何研發及生產工作外判給第三方派對。我們的生產廠房已能處理客戶下達的所有訂單所需的生產工作。我們的生產廠房配備熟練的勞動力及機械，用於生產後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案的所有步驟，包括但不限於JEDEC托盤、載帶、流量傳感器模塊及IC封裝，包括半密封傳感器封裝(ERAQFN)。

經過15年的經營歷史，憑藉強大的研發及產品開發能力，我們開發多元化的產品組合，擁有1300種不同的產品規格。當我們的客戶向我們詢問時，彼等會於後段半導體運輸介質的尺寸、形狀、顏色、材料組合及類型方面列出不同的規格。憑藉我們多樣化的產品組合，我們可能會向我們的客戶推薦我們現有產品組合中的產品(倘符合我們客戶的要求)。否則，我們的研發及材料工程部(由28名於後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案行業擁有研發專長的人員組成)將及時修改及調整我們現有的產品規格以滿足客戶的要求或從頭開始設計及開發新產品。我們亦不時進行市場調查，收集我們的銷售及市場推廣人員收到的有關市場資料，以便瞭解及分析我們研發計劃的市場趨勢，以設計及開發可用於半導體行業新半導體器件的新產品。於截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度，我們開發六種新產品的材料及設計應用，並進行16個關於新產品創新、材料進步及製

業 務

造工藝改進的研發項目。例如，於托盤及托盤相關產品方面，我們為潔淨室應用的托盤開發具有高清潔度的輕質MPPO(碳納米管)材料，以及層壓有一層溫度敏感特殊膠帶的高清潔度裸片托盤，便於半導體器件的拾取過程；於載帶方面，我們開發載帶上的二維激光碼標識，可單獨識別及追蹤儲存於載帶中的各個半導體器件，以促進我們客戶的製造過程；於MEMS及傳感器封裝解決方案方面，我們開發裸晶QFN/DFN封裝，可為傳感芯片提供堅固保護，使流量傳感器模塊能通過客戶要求的嚴格壓力測試。於最後實際可行日期，我們於中國、美國及香港共擁有15項註冊專利。有關我們研發能力的詳情，請參閱本節「研發」一段。憑藉我們多樣化的產品組合及強大的研發及產品開發能力，我們能夠跟蹤快速增長的半導體行業，我們能保留現有客戶並吸引半導體行業中來自國際知名品牌及跨國公司的新客戶。

鑑於客戶要求的大量變化，我們能夠通過自己的生產及設施控制產品的生產過程，以便我們能夠及時提供客戶指定的產品及更好地監控我們的產品質量。我們認為，我們的自營生產功能為我們的銷售功能創造協同效應，為我們的產品多樣化提供更多可能性，以滿足客戶的要求。

我們的銷售網絡對提升我們的銷售業績至關重要。我們於供後段半導體傳輸介質方面積累超過15年的營運經驗，並於提供MEMS及傳感器封裝解決方案方面擁有超過10年的經驗。經過多年的合作，我們的客戶已習慣我們的銷售程序、經驗豐富的銷售及市場推廣人員以及我們銷售辦事處、銷售點及第三方保稅倉庫的位置。我們完善的銷售職能對保持銷售業績的持續上升起了關鍵作用。

與半導體行業的主要國際客戶建立廣泛而穩固的關係，並擁有良好的聲譽及良好的業績記錄

我們以我們的知名品牌「UBoT」從事提供後段半導體傳輸介質超過15年。作為我們的主要分銷渠道，我們於香港、東莞、中國及新加坡設立銷售辦公室，以及於(i)中國上海，(ii)台灣臺北，(iii)台灣高雄，(iv)韓國首爾，(v)馬來西亞馬六甲，(vi)歐洲意大利，(vii)美國亞利桑那州及(viii)菲律賓設立銷售點，並派駐銷售代表聯絡相關地區的潛在及現有客戶，以便於全球範圍內更廣泛覆蓋及經營。根據F&S報告，我們於全球後段半導體傳輸介質行業的托盤及托盤相關產品製造商中排名第三，二零二零年市場份額約為7.6%。因此，我們相信，我們於多年經營中已開發出經驗證的高質量產品記錄。

業 務

作為後段半導體傳輸介質行業的供應商及MEMS及傳感器封裝解決方案行業的解決方案提供商，我們的客戶主要為半導體產品的跨國公司，例如STMicroelectronics。然而，根據F&S報告，該等半導體企業在與任何供應商就後段半導體傳輸介質的供應建立業務關係前，通常需要對該等供應商進行廠房審核，並對相關產品的供應商進行審核。為獲得客戶認可，我們於各方面均通過廠房審核，包括但不限於質量控制、原材料管理、工藝流程及客戶支持。於最後實際可行日期，我們為超過100名客戶的供應商。

此外，於我們獲得資格後的這些年，我們一直努力加強與客戶的關係。於最後實際可行日期，我們所有主要客戶均與我們維持超過10年的業務關係。駐紮於我們銷售點的銷售代表經驗豐富，經常與我們的客戶聯繫，以瞭解彼等的要求及對訂單的反饋。

基於我們於往績記錄期間收入的歷史增長，我們相信未來幾年客戶對我們後段半導體傳輸介質產品的需求將持續。根據F&S報告，捲帶包裝解決方案乃另一種後段半導體傳輸介質，能以相對較小的尺寸容納更多半導體器件，而IDM公司及無晶圓代工廠半導體公司等下遊客戶於整個製造過程中使用托盤及托盤相關產品以及載帶作為後段半導體傳輸介質。因此，董事認為我們與客戶建立的廣泛而穩固的關係允許我們自現有客戶捕捉對載帶及捲軸產品的市場需求。此外，董事認為，由於客戶傾向於向已通過廠房審核的合資格供應商採購，本集團一般較容易自客戶獲得新產品訂單。我們相信，作為一家合格的供應商以及我們與客戶建立的廣泛而穩固的關係，我們將更容易從客戶群中捕捉銷售載帶的機會。

此外，我們的業務主要涉及後段半導體傳輸介質產品的設計、開發、製造和銷售。我們並無從事包括電子生產工作在內的行業下游部分工作，旨在專注於提高我們的產品質量並避免與客戶的任何潛在競爭。我們的董事認為，我們經驗豐富的銷售及市場推廣人員以及於行業價值鏈中的戰略定位使我們能夠提高我們於目標客戶中的聲譽，並與他們保持穩定及長期的關係。

業 務

我們於銷售辦事處及不同銷售點的銷售及市場推廣人員的支持下，建立具有深度市場滲透的全球銷售網絡

雖然我們於香港、中國及新加坡設有銷售辦事處，並由我們的銷售、市場推廣及客戶服務部提供支持，但我們亦聘請銷售代表駐紮於全球不同國家的銷售點，我們的產品目前已於12個國家銷售。截至最後實際可行日期，我們於全球不同城市設有八個銷售點及八個第三方保稅倉庫，該等銷售點及保稅倉庫位於主要銷售區域，例如上海、臺北、高雄、新加坡、首爾、拉古納省、亞利桑那州及羅馬。由於我們的部分主要客戶為跨國公司，於不同地區及國家有不同的職能部門，我們於主要客戶附近設立銷售點，以便我們能夠提供及時的反應及技術支持，並定期拜訪客戶以保持業務關係。

我們的銷售辦公室及銷售點的廣泛地理覆蓋亦使我們能夠為不同地區的跨國客戶提供全面的服務和及時技術支援。我們完善的全球銷售代表擁有廣泛的營運、工程及技術專業知識，於後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案行業有豐富的經驗，對我們的產品有深入瞭解，因此，彼等能夠瞭解客戶的需求，並滿足客戶要求，於整個生產過程中與客戶密切溝通，確保我們的產品按照客戶要求的設計及規格進行適當的設計。我們於各銷售點的銷售代表均為本集團的非獨家獨立承包商，並負責擴充本集團業務，自本集團收取固定每月收入另加銷售佣金(介乎發票價值的0.15%至3.0%)。彼等不得從事會與作為本集團銷售代表有衝突的任何工作，例如代表本集團以外的後段半導體傳輸介質生產商。有關獨立承包商主要協調本地區客戶的訂單，解決技術問題並收集對我們產品質量的反饋。我們於如此多的地方的存在，也使我們能夠及時瞭解客戶產品的最新發展及該地區的市場趨勢，因此，我們處於有利地位，能夠迅速應對並利用任何地區的任何預期強勁經濟增長或其他積極的市場發展，例如任何預期的消費者消費能力或需求的增加。

經驗豐富的管理團隊及具有深厚行業知識的銷售及生產人員

我們專業及經驗豐富的管理團隊一直為我們於業務表現上取得顯著成功的關鍵因素之一。於最後實際可行日期，我們的執行董事兼控股股東湯先生於半導體行業及精密工程塑料製造方面擁有超過26年經驗。其他執行董事及高級管理團隊大部分亦平均擁有超過24年行業經驗。我們的管理團隊的特點為彼等對本集團的持續承諾、於後段半導體傳輸介質

業 務

及MEMS及傳感器封裝解決方案行業的專業執行能力以及財務管理知識。有關我們的董事及高級管理團隊的進一步資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

於過去十年的業務營運中，我們亦保留經驗豐富的員工，特別是銷售、市場及客戶服務部、製造部以及研發和材料工程部。於最後實際可行日期，我們的銷售、市場及客戶服務部有14名員工，彼等於行業內擁有廣泛的知識及聯繫，而我們的製造部及研發及材料工程部分別有271名及28名員工，彼等於生產及研發後段半導體傳輸介質、MEMS及傳感器封裝解決方案以及不同化合物塑膠材料的應用方面擁有豐富的經驗，展示專業技能及知識。

我們相信，我們的管理層及員工所擁有的豐富行業經驗及必要的行業知識對我們的高效業務營運及建立銷售網絡至關重要。

業務策略

通過促進生產過程的自動化、升級生產設施及購買必要的機器以提高我們的產能和能力

於最後實際可行日期，我們經營兩家生產廠房（沙田生產廠房及厚街生產廠房），共擁有四個生產設施，其中兩個負責生產托盤及托盤相關產品，其餘分別各自負責生產載帶及MEMS及傳感器封裝解決方案。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，托盤及托盤相關產品的生產設施估計產能分別約為25.5百萬件、32.9百萬件及16.1百萬件，而截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年，載帶生產設施的估計產能約為每年6.9百萬米寬度為24毫米的載帶，而截至二零二二年六月三十日止六個月則約為3.5百萬米。MEMS及傳感器封裝解決方案項下的流量傳感器模組的生產設施於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年的估計產能約為12,000件，而截至二零二二年六月三十日止六個月則約為6,000件，MEMS及傳感器封裝解決方案項下的半密封傳感器封裝(ERAQFN)生產設施於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年的估計年產能約為180,000件，而截至二零二二年六月三十日止六個月則約為90,000件。於往績記錄期間，我們有限產能（特別是托盤及托盤相關產品）表現為持續的高利用率，其詳情載於本節「生產能力及利用率」一段。

根據F&S報告，由於中國數字化程度提高，後段半導體傳輸介質行業的中國市場規模經歷溫和增長，隨著中國國內市場新興技術的持續發展，預計將以7.0%的複合年增長率由二零二二年的84.9百萬美元增長至二零二六年的111.4百萬美元。此外，由於東南亞地區勞動力及營運成本低以及全球供應鏈多樣化，東南亞國家為半導體製造商及IC組裝及封裝測試廠的熱門採購地，因

業 務

此，東南亞後段半導體傳輸介質行業的市場規模預計將由二零二二年的346.4百萬美元達至二零二六年的462.2百萬美元，複合年增長率為7.5%。為把握中國及東南亞市場的市場潛力，於半導體行業日益普及及技術進步推動我們的客戶預期增加需求的支持下，我們計劃通過(i)升級我們於中國的生產設施，以促進生產過程的自動化及提高產能，及(ii)於菲律賓實施載帶生產。我們預計，生產自動化水平提高及產能增加將使我們能夠擴大業務並於半導體生產鏈中獲得更多客戶。隨著我們產能及能力提升，我們相信本集團能滿足客戶對我們產品的需求，從而加強與客戶的關係，同時服務更多元化的客戶群。

升級我們於中國的生產設施

於最後實際可行日期，我們於中國東莞擁有兩家生產廠房，沙田生產廠房及厚街生產廠房，總建築面積約17,089平方米，配備四個生產設施。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，沙田生產廠房的托盤及托盤相關產品的有效利用率分別為94.3%、95.4%及92.69%，而截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年六月三十日止六個月厚街生產廠房的有效利用率為89.5%及96.99%。我們的厚街生產廠房於二零二一年六月完成第一期工程及機器安裝，預計於二零二二年最後季度開始第二期工程，並於二零二四年底完成。

(i) 托盤及托盤相關

根據F&S報告，由二零二二年至二零二六年，後段半導體傳輸介質行業的托盤及托盤相關產品的全球市場規模預計將以5.3%的複合年增長率增長，特別是中國的托盤及托盤相關產品的市場規模預計將以8.7%的較大複合年增長率增長，由二零二二年的40.9百萬美元增至二零二六年的57.1百萬美元。鑑於後段半導體傳輸介質行業對托盤及托盤相關產品的市場需求上升以及我們現有生產設施的高利用率，我們的目標為擴大生產規模，提高我們的生產工藝，於沙田生產廠房及厚街生產廠房實施自動化生產基礎設施，以生產托盤及托盤相關產品，從而進一步提高我們的生產能力及效率。於往績記錄期間，沙田生產廠房已充分利用產能。我們的目標為於我們的生產廠房實施及升級我們的自動化生產基礎設施，以盡量減少人工流程，進一步提高我們於托盤及托盤

業 務

相關產品製造過程中的生產效率及產能，同時提高生產精度，從而提高產品質量。至於生產托盤的後處理過程，包括清潔及檢查，倘我們的生產設施涉及勞動密集型及需要較低技能水平的步驟能自動化，以處理大量托盤及托盤相關產品，將為有利。就厚街生產廠房而言，本公司已於二零二一年厚街生產廠房開始營運時透過安裝自動設備／機器採納高水平的自動化生產過程，包括高精度注塑機、除濕機、機械臂及破碎機。本公司擬採納循序漸進方式進一步提升厚街生產廠房的產能及自動化水平。

有鑑於此，我們擬升級我們於中國的生產設施，以促進自動化及增加托盤及托盤相關產品的生產能力。我們的董事認為，我們的生產過程自動化程度更高將降低我們的生產成本（特別是勞動力成本），並提高我們的產能，對我們未來業務營運的有效擴展至關重要。

下表載列我們中國生產設施的托盤及托盤相關產品擴充計劃，包括將予購買的機器及／或設備數目、投資成本、將予動用的[編纂]明細、主要實施時間表及完成後增加的產能：

計劃	用途	投資成本	[編纂]	主要實施時間表	完成後增加的產能
(i) 購買自動機器及／或設備	<ul style="list-style-type: none">升級現有注塑機提升生產的自動化水平	[編纂]	[編纂]	第一階段—於[編纂]後開始，於二零二三年年中完成	於全面營運後沙田生產廠房及厚街生產廠房合共為約18百萬件
(ii) 建立一個控制室，配備自動化機械，用於粉碎回收托盤及混合材料					
(iii) 以自動機器及設備升級厚街生產廠房的倉庫					

業 務

計劃	用途	投資成本	[編纂]	主要實施 時間表	完成後增加 的產能
<ul style="list-style-type: none"> • 6套三維視覺檢測系統 • 35套自動裝載機械人系統 • 4台電動升降車 	<ul style="list-style-type: none"> • 自動化托盤及托盤相關產品的質量檢查程序，以改進產品質量及一致性 • 促進收集及裝載成型品 • 20套設有自動化輔助設備的注塑機 	<ul style="list-style-type: none"> • 擴充產能 		<p>於二零二三年年中開始及二零二四年初完成</p> <p>於二零二三年年中開始及二零二五年年中完成，每六個月購買五部設有自動化輔助設備的注塑機</p>	

業 務

(ii) 載帶

根據F&S報告，半導體器件的封裝方法已向小型化及更高的終端產品效率發展。採用協議代碼(即QFN樣式、DFN及WLCSP)的最新封裝方法設計乃快速增長的細分市場，利用表面貼裝及晶圓級技術簡化製造流程，並越來越多應用於不同類型的電子產品，如電動汽車、消費電子產品及醫療器械。由於載帶及捲盤設備通常用於將元件送入自動貼裝機以進行板載組件表面安裝，因此表面貼裝封裝方法的不斷進步將推動對載帶及捲盤的長期需求。後段半導體傳輸介質行業的全球載帶及捲盤市場規模預計將以8.2%的複合年增長率由二零二二年的629.2百萬美元增長至二零二六年的862.4百萬美元。為滿足載帶產品的預期不斷增長的需求，董事認為提高載帶產品的產能迫在眉睫。因此，我們於沙田生產廠房安裝第一條載帶生產線，於二零一八年開始試生產載帶。介質行業於全球擁有成熟的客戶群，且市場上出現使用捲帶包裝解決方案的增長趨勢，我們相信，我們已做好充分準備，抓住全球不斷增長的載帶及捲盤市場。

本集團有意擴展中國及菲律賓的載帶產能，以服務現有客戶及吸納新客戶。

我們於中國的載帶產能擴張計劃主要涉及為我們的沙田生產廠房購置生產機器、設備及配套系統。下表載列我們中國沙田生產廠房的載帶產能擴充計劃，包括將予購買的機器及／或

業 務

設備數目、投資成本、將予動用的[編纂]明細、主要實施時間表及完成後增加的產能：

計劃	用途	投資成本	[編纂]	主要實施 時間表	完成後增加 的產能
(i) 購買自動機器及／ 或設備	增加產能以把握全球 不斷增長的載帶及 捲軸市場	[編纂]	[編纂]	於二零二四年年 初開始，預期將 於二零二四年年 中完成	全面營運後， 24毫米闊載帶的 額外年產能將為 約4.8百萬米
• 1條全自動旋轉 載帶生產線					
• 2台半自動平板 載帶機					
• 輔助支持系統、 設備及模具 工具					
(ii) 改造沙田生產廠房 的生產區					

對於我們於菲律賓的載帶產能擴張計劃，請參閱下文「業務－業務策略－於菲律賓實施載帶生產」一節。

(iii) MEMS及傳感器封裝解決方案

MEMS傳感器封裝行業被認為是高度專業化的行業，需要復雜且較長的产品開發週期、廣泛的技術知識以及對相應機械的大量投資。該行業為多學科，涉及電子、機械、材料、工藝製造、物理學等領域。隨著生產需求的激增及設計複雜性的提高，對專業人士及人才的需求顯著增加，而高精通科研的人力供應不足。因此，中國MEMS壓力傳感器企業規模相對較小，產品開

業 務

發週期較長，於量產前需要對生產線及終端產品質量進行大量研發。例如，蘇州一家MEMS傳感器製造商於二零一六年公開轉讓招股章程中披露，於當地代工廠完成MEMS傳感器製造工藝及封裝工藝的技術開發工作歷時5年多。然而，隨著物聯網的發展，對壓力傳感器的物理尺寸、功耗及成本提出更高要求，MEMS及傳感器的使用由於其競爭優勢而穩步增加，應用場景越來越多樣化。由於中國的MEMS及傳感器封裝行業目前正處於發展階段，市場相當分散，現有企業通過提供穩定的產品流、建立長期的業務關係以保持客戶黏性、招募高素質的技術工人、應用專業的機器設備、實施嚴格及全面驗證，從而取得優異成績。MEMS及封裝解決方案行業的高度分散歸因於終端產品的多樣性及對不同行業的覆蓋，即消費電子、汽車、醫療保健、工業等。

MEMS設計向射頻器件、壓力傳感器及麥克風等電子產品的擴散，加上高複雜性及各種技術挑戰及要求，促成對MEMS及傳感器封裝解決方案的持續需求。根據F&S報告，二零一六年至二零二一年全球MEMS及傳感器封裝解決方案行業收入市場規模由約2,961.7百萬美元增至約5,273.9百萬美元，複合年增長率為約12.2%，預計二零二二年至二零二六年的複合年增長率約為6.0%，達約7,362.6百萬美元。鑑於MEMS及傳感器封裝解決方案的需求不斷增長，我們擬購買自動化機器及設備，以增加沙田生產廠房的產能並提高我們的產品開發能力，將使我們於MEMS及傳感器封裝解決方案方面的產品組合多樣化。下表載列我們中國沙田生產廠房的MEMS及傳感

業 務

器封裝解決方案產能擴充計劃，包括將予購買的機器及／或設備數目、投資成本、將予動用的[編纂]明細、主要實施時間表及完成後增加的產能：

計劃	用途	投資成本	[編纂]	主要實施時間表	完成後增加的產能
<p>購買自動機器及／或設備</p> <ul style="list-style-type: none"> • 為特殊傳感器模塊應用提供裸片封裝的封裝方法的成型系統機 • 具有更高速度及貼片準確度並能夠處理更多貼片控制要求的貼片機 • 促進檢查程序自動化的自動光學檢測機 (*對本公司而言為全新設備) 	<p>提升沙田生產廠房的產能及提升產品開發能力，從而令MEMS及傳感器封裝解決方案的產品組合更多元化</p>	[編纂]	[編纂]	<p>分為兩個階段，預期於二零二三年年中開始及預期於二零二四年年中完成</p>	<p>沙田生產廠房全面營運後的額外年產能為約0.3百萬件流量傳感器模塊及0.6百萬件半密封傳感器封裝(ERAQFN)</p>

業 務

於菲律賓實施載帶生產

菲律賓、馬來西亞及泰國等東南亞國家因其具有競爭力的勞動力成本而成為半導體製造商及IC封裝測試廠的熱門採購目的地，加速東南亞半導體產業的增長，推動並加快東南亞後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案行業的未來發展。根據F&S報告，除全球後段半導體傳輸介質行業對載帶及捲軸的市場需求激增外，東南亞後段半導體傳輸介質行業的載帶和捲軸的市場規模預計將由二零二二年的230.3百萬美元達至二零二六年的312.0百萬美元，複合年增長率為8.0%。鑑於東南亞對載帶的市場需求激增，並利用我們於後段半導體傳輸介質行業的老客戶，我們亦有意將我們的製造業務擴展至菲律賓，以把握東南亞市場載帶的增長。

於最後實際可行日期，本集團一直積極增加與我們擁有相當大的經營規模的現有載帶產品客戶的產品認證。除此之外，於最後實際可行日期，本集團與其他國際客戶亦處於查詢階段，其中包括已與我們建立關係的現有托盤及托盤相關產品客戶。儘管本集團並非該等客戶的載帶產品獨家供應商，且本集團與該等客戶亦無訂立具法律約束力的文件，惟董事認為，其不會損害該等客戶對我們產品的潛在需求，原因為半導體生產商及IC組裝廠在不同地區有數間供應商，以在供應鏈中斷的情況下降低營運風險屬行業慣例，客戶對產品進行認證（而非訂立任何框架協議）為有意展開業務關係的象徵。

有鑑於此，為於菲律賓實現載帶生產，我們計劃尋找於菲律賓拉古納擁有一個生產基地並有人力支持該基地的基本運作的潛在商業夥伴，同時我們打算將我們收購的機器及設備放置於菲律賓的生產基地。菲律賓生產基地的預計規劃最小建築面積為1,200平方米，設有載帶、原料庫、物料粉碎室、塗裝室、質檢室、模具室及辦公室等的一套生產設施。

業 務

下表載列我們在菲律賓生產的生產實施計劃，包括將予購買的機器及／或設備數目、投資成本、將予動用的[編纂]明細、主要實施時間表及增加的產能：

計劃	用途	投資成本	[編纂]	主要實施 時間表	增加的產能
<p>購買自動機器及／或設備</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3條全自動旋轉載帶生產線 • 6台半自動平板載帶機 • 輔助支持系統、設備及模具工具改造生產區 	<p>擴充我們於菲律賓的生產佔有率，以把握東南亞市場的載帶增長</p>	[編纂]	[編纂]	<p>分為兩個階段，預期於二零二四年年中開始及於二零二五年年中完成</p>	<p>全面營運後，24毫米闊載帶的額外年產能將為約14.3百萬米</p>

就菲律賓的建議擴充而言，我們已對設立生產廠房進行內部可行性研究。根據我們的研究，管理層認為本集團可憑藉過往營運OEM廠房的經驗及管理專業知識，以東南亞的業務營運把握客戶對載帶產品的預期需求增加以及東南亞市場持續增長的商機。有關我們過往營運OEM廠房的經驗，請參閱「歷史、發展及重組」一節。我們亦已識別出支持我們於菲律賓擴充的若干有利因素，包括(i)由於勞動力成本具競爭力、稅率及其他營運開支低，故於菲律賓營運生產場地符合成本效益；及(ii)本集團亦能夠就菲律賓的生產取得原材料供應，原因為原材料將由本公司向中國、泰國及台灣供應商採購，其後托運至菲律賓。董事亦認為，其他東南亞國家相比，於菲律賓設立生產廠房為本集團帶來更多利益，因為(i)本集團的主要客戶於菲律賓擁有龐大的生產基地，因此本集團可以更好地滿足彼等之需求；(ii)考慮到我們於往績記錄期間在菲律賓產生的收

業 務

入於東南亞地區排名第一，本集團熟悉菲律賓市場；及(iii)本集團擁有現成的工程師可派駐菲律賓，以監察產品現場的生產過程(如有需要)。

鑑於我們現有的兩間生產工廠均位於中國，董事亦認為，菲律賓的擴張計劃可通過增設生產設施以降低我們的經營風險。此外，由於靠近菲律賓，每米載帶的單位成本較低，因此本集團可提高我們於載帶產品定價方面的競爭力。下表載列於菲律賓經營生產廠房與於中國經營生產廠房的成本的成本效益分析。

成本組成部分	倘於中國 生產的每米 載帶估計 單位成本 (美元)	倘於菲律賓 生產的每米 載帶估計 單位成本 (美元)	每單位米 載帶的 估計節省 成本總額 (美元)
原材料	0.0132	0.0132	不適用
間接材料	0.0053	0.0053	不適用
勞動力成本(附註1及2)	0.0008	0.0005	0.0003
使用權資產折舊／廠房租賃成本 (附註3)	0.0015	0.0016	0.0001
物流成本(附註4)	0.0082	0.0007	0.0075
總計	0.0290	0.0213	0.0077

附註：

我們於進行成本效益分析時作出以下主要假設：

- (1) 基於使用六條生產線、每條生產線每小時3,000米、每日22個工作時數及一個月26個生產日的估計產出計算。
- (2) 基於估計一台機器使用兩名操作員，一名負責裝載操作及另一名負責包裝計算。
- (3) 基於生產設施的樓面面積1,200平方米計算。
- (4) 生產載帶的物流成本包括原材料的運輸成本及向本集團於菲律賓的客戶交付製成品的成本。

根據成本效益分析，實施於菲律賓生產載帶的成本低於中國，估計節省約26.6%成本，主要原因為於菲律賓產生的勞動力成本及物流成本較低。

業 務

此外，根據F&S報告，菲律賓為亞洲製造中心之一。菲律賓於過去數年的勞動力供應穩定，尤其是製造業，製造業於二零一零年代佔總就業人數約8%。製造業工人一般需要培訓，並為機械操作員、技術人員及工程師等技術工人。此外，菲律賓擁有超過400個經濟區，各經濟區均向外國投資者提供自身的不同財政及非財政激勵措施，當中部分擁有大型生產設施及相關設施。鑑於上文所述，具有技術工人及業務合作夥伴以及大量土地供設立生產場地均將支持本集團於菲律賓半導體市場發展。

於最後實際可行日期，我們正在就該實施計劃選擇業務合作夥伴。我們對業務合作夥伴的選擇標準主要包括以下各項：(i)位於自由貿易區的生產場地具有所有必要的許可證及批准，(ii)有足夠的操作員以支持生產場地的生產，(iii)建立生產場地的運輸網絡以到達我們的客戶，(iv)生產場所適當遵守當地法律法規，及(v)無塵製造環境的可用性。在本集團擬將產品生產委託予潛在合作夥伴的同時，我們會承擔銷售及營銷、產品設計及開發、模具設計、管理及生產以及材料工程。我們亦會指派工程師駐菲律賓，以監管生產過程。

業 務

計劃	大約投資成本	資金來源	投資回報期 ^(附註)
於菲律賓實施載帶生產	合共[編纂]用於(i)購買三條全自動旋轉載帶生產線；(ii)購買六台半自動平板載帶機；(iii)購買輔助支持系統、設備及模具工具；及(iv)改造生產基地	[編纂]	大約35個月(假設利用75%產能)

附註：假設每個未來計劃均已全面實施。

詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」。

加強我們於全球市場(包括中國市場)的銷售及營銷力度

全球市場

根據F&S報告，就後段半導體傳輸介質的全球製造市場而言，全球市場規模預計將由二零二二年的948.3百萬美元增長至二零二六年的13億美元。其中，就托盤及托盤相關產品而言，全球市場規模預計將由二零二二年的293.0百萬美元增長至二零二六年的360.6百萬美元，而就載帶及捲軸而言，全球市場規模預計將由二零二二年的629.2百萬美元增長至二零二六年的862.4百萬美元。此外，於全球MEMS及傳感器封裝解決方案行業市場方面，預計全球市場規模將由二零二二年的58億美元增長至二零二六年的74億美元。鑑於後段半導體傳輸介質市場以及MEMS及傳感器封裝解決方案市場的上升趨勢，我們計劃通過加強我們於現有市場的銷售力度及市場滲透、擴大我們的客戶群、開拓新市場及提高本集團於全球的認可度以增加我們於行業中的市場份額。我們深信採取有效的市場推廣策略作為提高本集團的市場意識及認可度以增加市場份額及確保長遠可持續增長的重要性。其中，我們打算通過於美國波士頓建立新的銷售點以實現上述目標，方法為於馬來西亞及菲律賓分別招聘一名銷售代表及兩名技術支援銷售代表，通過提供客戶服務以支持銷售及市場推廣職能，為客戶提供質量保證和技術支持，以期擴大我們於各個地區的銷售和市場推廣，以專注於招攬新客戶。

業 務

中國市場

根據F&S報告，就區域發展的角度而言，中國的後段半導體傳輸介質製造市場已顯示出增長潛力，二零二二年至二零二六年市場規模的預測複合年增長率為7.0%，並預期由二零二二年的84.9百萬美元增長至二零二六年的111.4百萬美元。特別是托盤及托盤相關產品，預計中國市場規模將由二零二二年的40.9百萬美元增長至二零二六年的57.1百萬美元，複合年增長率為8.7%，而就載帶及捲軸而言，預計中國市場規模將由二零二二年的44.0百萬美元增長至二零二六年的54.4百萬美元，複合年增長率為5.4%。此外，就MEMS及傳感器封裝解決方案的中國市場而言，中國的銷售價值預計將由二零二二年的32億美元增長至二零二六年的41億美元，複合年增長率為6.3%。

鑑於中國的市場潛力，我們打算加強我們的銷售及市場推廣工作，以進一步提高客戶忠誠度、聲譽及市場認可度。特別是經計及市場對托盤及托盤相關產品的需求快速增長，我們擬專注於擴大我們於中國銷售托盤及托盤相關產品的銷售及市場推廣力度。為利用我們的能力及技術訣竅，我們打算加深對現有客戶的銷售滲透，並與中國的新客戶建立業務關係。為配合我們提高產能及研發能力的擴張計劃，我們擬於成都及深圳設立新的銷售點，於各新銷售點招聘兩名銷售代表，以(i)加強並與我們現有的主要客戶建立更緊密的關係；(ii)鎖定高端品牌的新客戶；(iii)佔領中國當地市場；及(iv)擴大我們的市場立足點，以加強我們於中國西南地區的市場覆蓋率並滲透中國甘肅及天水市場。

我們擬將[編纂][編纂]的[編纂]或[編纂]用於上述策略。詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」。

採購ERP系統及升級資訊系統以提高效率並降低成本

我們尋求提高我們的效率，並於生產及營運中實現成本削減。我們打算通過(i)購買ERP系統以整合香港及中國的辦公室，及(ii)通過升級相關硬件、軟件、網絡及服務器以支援ERP系統，從而改善我們的營運效率。預計ERP系統將為我們提供一個綜合實時追蹤核心業務流程，如生產、訂單處理、與應收賬款和應付賬款有關的會計資料及庫存管理，使我們能夠以更有效及高效的方式協調業務管理。同時，ERP系統通過提高我們日常營運的自動化程度，減少對我們業務流

業 務

程的人工干擾，從而降低人為錯誤的風險。憑藉先進的ERP系統，董事相信，我們可提高我們的營運效率，讓我們能夠投入更多資源發展業務。我們認為，我們可通過加大力度改善及簡化我們的營運流程及控制以實現更高程度的成本效益，從而實現進一步節約。我們認為系統升級將使我們能夠加強客戶管理人力資源管理及各部門之間的溝通，快速響應供應鏈及採購訂單的變化，便於我們對庫存控制、生產調度進行數據分析及物流規劃。

我們擬將[編纂][編纂]的[編纂]或[編纂]或購買及實施新的集中式ERP系統及升級我們的信息系統。詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」。

進一步加強我們的研發能力，以擴大我們的產品供應、原材料和生產技術

技術進步的迅速性質及消費者對電子設備及半導體的日益依賴對我們的業務營運及產品供應以及後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案行業的發展產生重大影響。認識到後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案的市場潛力受半導體市場增長及發展的推動，我們將根據市場趨勢和需求不斷設計及開發新產品和材料，並改進我們現有產品以實現功能增強及／或成本效率。為跟上半導體行業的市場趨勢，我們認為不斷擴大我們的產品組合至關重要。為及時響應客戶的新規格要求，擴大我們的產品供應，以及實施產品升級的需要，我們認為通過不斷創新產品設計及發明密切適應最新行業發展及技術的新產品以不斷提高我們的產品範圍至關重要。此外，我們打算進一步努力研究未來潛在市場的創新產品開發、成本效益高的材料開發及以客戶為導向的新產品及解決方案開發。鑑於載帶於後段半導體傳輸介質行業的市場不斷增長，我們打算研究及開發用於半導體晶圓級封裝及醫療行業的載帶，以及錘計及環境保護的可生物降解載帶材料。因此，我們將進一步提高我們的研究及開發能力作為我們的關鍵業務戰略之一。

為配合我們未來的研發計劃，以及於開發先進產品及生產技術方面實現高研究速度和質量的人力及專業知識需求，我們擬增聘約五名具有豐富的同類行業產品開發及專用設備開發經驗及／或相關學科的良好教育背景的研發人員（如研究工程師、材料專家及模具設計工程師），專注於材料工程、產品設計及製造過程的研發項目。此外，我們認為引進模具設計軟件及升級我們

業 務

的開發設施，為我們的產品設計及開發提供先進和高效的平台至關重要。因此，我們亦打算購買先進的模具設計軟件，以部署用於新產品設計。此外，正如沙田生產廠房的MEMS及傳感器封裝解決方案的擴展計劃所示，我們打算購買若干機器及設備，例如芯片貼裝機及自動化光學檢測系統。我們相信，該等機器及設備亦將提升我們於MEMS及傳感器封裝解決方案方面的產品及技術開發能力，並整體提升我們研發過程的效率。我們亦相信，我們研發能力的增強將使我們能夠增加我們可進行的研發項目數量，從而加快我們開發新產品設計、升級現有產品及改善我們的生產營運。

我們擬將[編纂][編纂]的[編纂]或[編纂]用於上述策略。憑藉我們強大的研發能力，我們努力通過為現有客戶及潛在新客戶擴展我們的產品供應以增加我們的市場份額。我們的董事認為，我們產品供應的多元化及擴展將提升我們於後段半導體傳輸介質行業的地位，並增加我們於MEMS及傳感器封裝解決方案行業的市場份額。

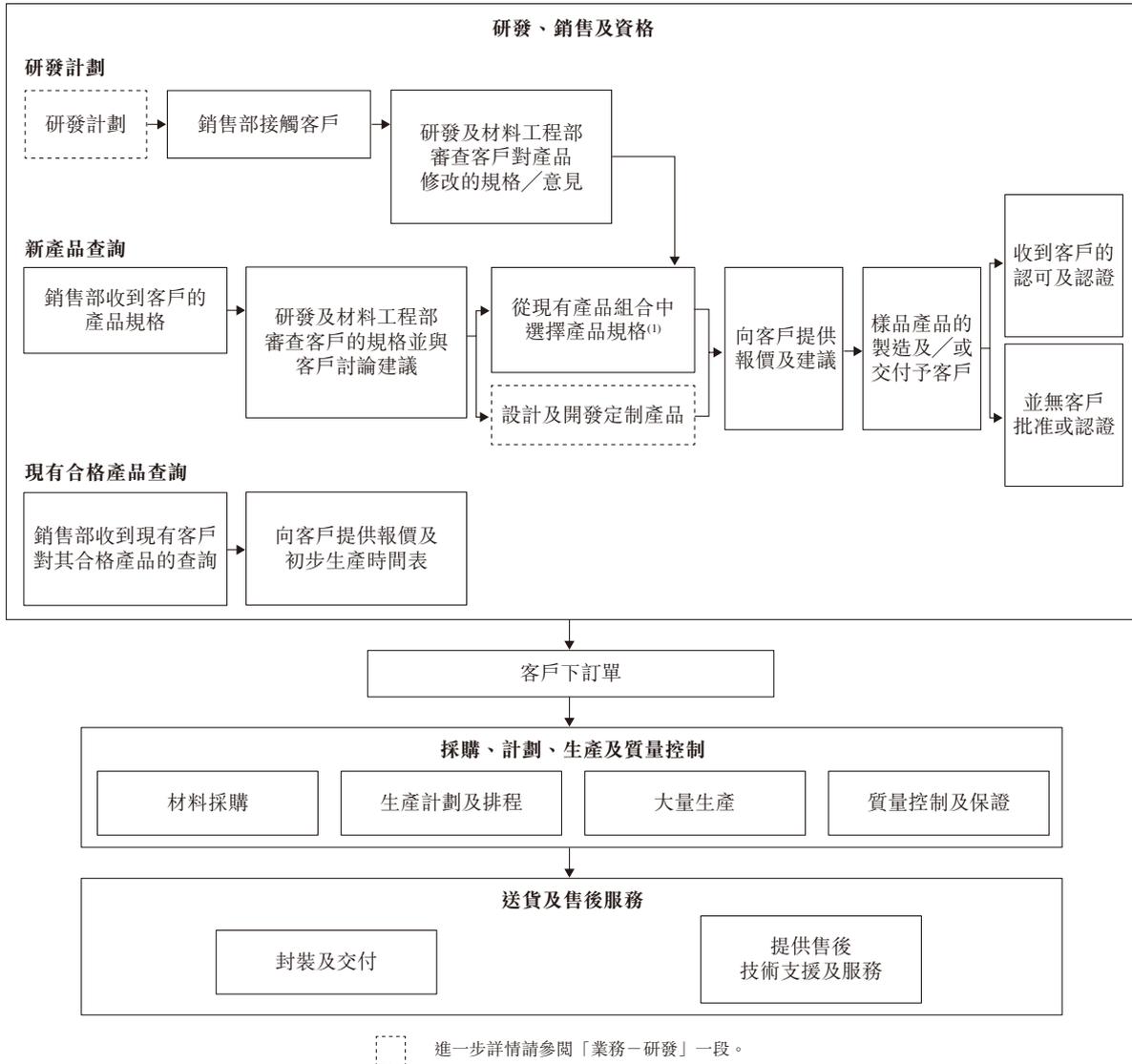
我們的業務模式

我們為一家托盤及托盤相關產品的後段半導體傳輸介質製造商。除專注於托盤及托盤相關產品的設計、開發、製造及銷售外，自二零一九年起，我們亦將載帶納入我們的產品類別。除後段半導體傳輸媒體外，我們亦為MEMS及傳感器封裝解決方案的供應商。我們的後段半導體運輸媒體產品主要用於保護半導體器件，包括功率分立半導體器件、光電子、集成電路及傳感器等，使其於運輸、儲存及使用過程中免受不同形式的損害。至於我們的MEMS及傳感器封裝解決方案，我們提供一種旨在保護MEMS及傳感器等半導體器件的封裝，以促進向電子設備的電路板傳遞信號的電接觸，並避免潛在在外部因素的破壞及老化的腐蝕作用。於往績記錄期間，我們為龐大的客戶群服務，包括若干國際IDM公司、無晶圓廠半導體公司及IC組裝及封裝測試公司，如STMicroelectronics，我們的收入主要來自托盤及托盤相關產品的銷售。

作為於行業內擁有超過15年經營歷史的後段半導體傳輸介質製造商之一，我們一直致力於發展一種特別注重產品開發的商業模式，我們與客戶的長期合作關係證明客戶對我們的高度重視。於產品開發階段，我們對後段半導體傳輸介質的結構性設計及材料工程進行研究及開發，並為客戶的產品定制MEMS及傳感器封裝解決方案。

業 務

下圖說明我們營運的營運模式：



- (1)：我們現有產品組合包括(i)由我們的研發項目開發的新產品規格及(ii)我們為客戶開發的產品規格。於最後實際可行日期，我們的產品組合包括超過1,400種產品規格，包括研發部門根據JEDEC行業標準設計及開發，並向所有客戶建議的約800種新產品規格，以及我們專門為客戶開發的約600種產品規格，該等產品規格由研發部門在客戶協助下設計及開發，專為客戶的特定要求定製，一般不會向本集團其他客戶建議。

研發、銷售及資格

我們有自己的新產品設計及開發的研發計劃，亦收到客戶對新產品及現有合格產品的詢問。

業 務

對於研發計劃，根據我們的銷售及市場推廣人員進行的市場研究及由市場獲得的資料，我們的研發及材料工程部設計及開發新產品，並更新和增強我們現有產品組合中的產品規格。一旦有新設計及開發的產品，我們的銷售及市場推廣人員將積極接觸我們現有或潛在客戶進行介紹。

業 務

於收到客戶對新設計及開發的產品的反饋後，我們的研發及材料工程部將根據客戶提供的具體要求於產品開發時進一步定制及修改產品。有關我們的研發及產品開發的詳情，請參閱本節「研發」一段。

對於客戶提出的新產品詢價，於我們的銷售及市場推廣人員收到客戶要求規格的詢價後，我們的研發及材料工程部將審查客戶的規格並與客戶討論推薦。我們通常會要求客戶向我們提供產品目錄，以便徹底瞭解彼等的需求，對其半導體器件類型進行技術審查，並推薦現有產品規格或設計最適合彼等的定制產品。倘產品能夠滿足客戶要求，我們會由現有產品組合中選擇產品規格，或根據需要對現有產品規格進行修改及調整。否則，我們將根據客戶提供定制產品的口袋形狀及配置以及質量標準等具體要求，設計及開發定制產品。

對於客戶提出的研發計劃及新產品詢價，於客戶確認產品類型後，我們會向彼等提供報價及建議。然後，我們將製造及／或向我們的客戶交付樣品以獲得批准及資格。批准及認證我們的產品的客戶將繼續下達訂單。

對於詢問其現有合資格產品的客戶，我們一般會於收到彼等的詢問後提供報價及生產計劃供其考慮。

客戶下達訂單

於我們的客戶批准及認證我們的新產品以及詢問我們現有合資格產品時，我們會要求客戶向我們提供數量、封裝、交貨時間表及交貨方式，以便我們評估現有原材料庫存水平及生產計劃是否能夠滿足客戶的需求。一旦確認生產及交貨時間表，我們的客戶向我們發送採購訂單，我們將通過電子郵件確認採購訂單。

採購、計劃、生產及質量控制

於客戶向我們發出採購訂單後，我們將製定生產計劃及時間表。就採購而言，我們一般根據我們每月編製的採購計劃採購原材料。我們隸屬於行政及運營支援部的採購團隊亦會不時向供

業 務

應商採購額外原材料，視乎我們所需原材料的庫存水平而定。我們的製造部將按照與客戶協定的規格以及生產計劃和時間表進行批量生產。有關生產過程的詳情，請參閱本節「生產－我們的生產過程」一段。於生產過程中，我們的質量保證部會於每個生產步驟進行各種監測及檢查。此外，我們的質量保證部將於生產過程後對我們的產品進行監測及檢查，以確保產品符合客戶的規格和所需的質量標準。有關我們的質量控制及保證流程的詳情，請參閱本節「質量控制」一段。

交付及售後服務

一旦我們的成品通過質量控制監測及檢查，我們將根據客戶要求安排產品封裝及交付。就交付而言，我們可能會將產品交付至(i)靠近客戶最終交付地址的第三方保稅倉庫，以便按照客戶指定的交付時間表繼續交付，或(ii)直接交付至客戶或其倉庫的地址。

我們努力為客戶提供優質有效的售後服務及技術支持，並收集有關我們產品質量的反饋，以用於未來的產品改進。

倘我們的客戶發現缺陷，我們的客戶可能會拒絕我們的產品或根據我們的產品更換政策要求更換產品。有關我們的產品退貨及保修政策的詳情，請參閱本節「客戶－產品缺陷及更換」一段。

對於若干長期客戶，我們定期進行實地考察，對我們產品的性能進行審查及檢查。我們亦為若干長期客戶提供免費的技術諮詢服務，我們會不時檢查彼等的機器，分析機器性能，並使用最新的技術評估我們的產品於彼等的機器上的有效性。

我們的產品

我們主要從事後段半導體傳輸介質的設計、開發、製造及銷售，包括托盤及載帶，主要用於在運輸、儲存和使用過程中保護半導體器件，包括功率分立半導體器件、光電、IC及傳感器等。我們亦提供MEMS及傳感器的封裝解決方案，旨在促進向電子設備的電路板傳遞信號的電氣接觸，同時亦保護MEMS及傳感器免受潛在外部因素的破壞及歲月腐蝕影響。因此，我們的產品於半導體器件的製造過程中發揮關鍵作用，並迎合各種類型的電子產品，如平板電腦、智能手機及個人電腦等。我們已建立超過1,300種產品規格的廣泛產品組合，滿足客戶的規格及所需的質

業 務

量標準。我們所有產品均符合RoHS及REACH標準，以滿足所需的行業標準。我們的產品一般可分為三類：(i)托盤及托盤相關產品；(ii) MEMS及傳感器封裝解決方案；及(iii)載帶。

以下載列本集團於往績記錄期間按產品類別劃分的收入明細：

產品類別	截至十二月三十一日止年度				截至六月三十日止六個月			
	二零二零年		二零二一年		二零二一年		二零二二年	
	估總數		估總數		估總數		估總數	
	收入	的百分比	收入	的百分比	收入	的百分比	收入	的百分比
千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%	
	(未經審核)							
托盤及托盤相關	157,303	94.8	195,429	96.3	88,407	96.5	117,170	97.2
MEMS及傳感器								
產品封裝	8,467	5.1	7,152	3.5	3,002	3.3	3,133	2.6
載帶	209	0.1	367	0.2	179	0.2	201	0.2
合計	<u>165,979</u>	<u>100.0</u>	<u>202,948</u>	<u>100.0</u>	<u>91,588</u>	<u>100.0</u>	<u>120,504</u>	<u>100.0</u>

我們的托盤及托盤相關產品

托盤為半導體及微電子行業通常用於安全處理、運輸及儲存中和大尺寸的半導體器件，如IC、模塊及其他部件。由於我們的托盤乃專門用於在生產鏈的設施之間的運輸過程中支撐半導體器件，因此通常設計為特定形狀，用於將指定半導體器件固定於托盤上，以避免任何外力造成的損壞。托盤相關產品包括端蓋及標籤，用於處理及捆綁整個托盤堆，並便於對托盤進行分類和編碼。

托盤被模製成矩形輪廓，具有均勻間隔及固定尺寸的口袋，用於放置芯片，且可堆疊及捆綁在一起以形成標準封裝配置。該間距為用於取放板組裝工藝的標準工業自動化組裝設備提供精確的半導體位置。托盤由含碳塑膠的模塑膠製成，具有提供ESD、機械完整性及熱穩定性的基本特性。不同的客戶會對托盤的規格擁有不同的要求，我們能因應客戶的要求生產JEDEC托盤及非JEDEC托盤。JEDEC標準為一個開放行業標準，主要是為提供公認的技術標準並允許不同電氣組件之間的互操作性而建立。托盤的配置一般符合JEDEC標準，其中規定(包括但不限於)不同封裝的封裝外形圖、包裝數量、矩陣等。

業 務

根據托盤所在的半導體器件的應用及客戶規格，我們的托盤於口袋形狀、配置、ESD特性、材料構造、耐熱性、清潔度、厚度、剛性及顏色方面有所不同。因此，我們根據客戶的需求製造各種結構設計及材料配方的托盤。由於材料混合及改性允許工程塑膠的特性在廣泛的範圍內進行優化以適應不同的應用，我們的研發及材料工程部擁有專業知識及技能，通過設計及開發複雜的材料配方修改原材料，以設計涵蓋廣泛不同屬性的材料，如不同的溫度等級、ESD特性、顏色、機械強度及清潔程度等的組合，以滿足客戶的要求及預期應用。特別是，我們的產品乃由PPO及ABS等塑膠原料、回收塑膠材料、再複合塑膠材料及定製塑膠材料配方混合而成，我們一般提供JEDEC托盤，其耐熱溫度範圍為攝氏75度至攝氏180度，ESD特性為(i)10e4–10e9及(ii)10e5–10e11。我們的客戶通常根據其半導體產品須經過的可靠性程度以指定托盤的溫度等級及ESD特性，因此，托盤的耐熱性及ESD特性成為其中最關鍵的特性。例如，我們設計MPPO(碳納米管嵌入)材料，以實現清潔度、ESD保護性能及強度的平衡。

於我們的托盤及托盤相關產品的結構設計方面，我們的研發及材料工程部會對客戶的半導體器件進行模擬及結構分析，專門設計出適合客戶半導體器件類型和形狀的產品結構設計。除口袋形狀及配置，我們的研發及材料工程部亦將根據客戶的規格或根據我們的研發成果，定制托盤及托盤相關產品的結構設計，以提高產品性能。例如，我們設計裸芯片托盤，層壓有一層對溫度敏感的特殊膠帶，以方便半導體器件的拾取過程。鑑於我們產品規格的結構設計及材料配方的各種組合，我們的托盤及托盤相關產品並無特定的產品類別。

我們的托盤及托盤相關產品的售價介乎4.7港元至50.7港元。我們的托盤及托盤相關產品的售價可能因多項因素而有很大差異，包括(i)產品的類型、複雜性及設計，(ii)客戶指定的材料及規格，(iii)塑膠材料組合成本，(iv)生產成本，(v)產品功能，(vi)相同採購訂單數量，(vii)客戶涉及的市場分部，(viii)我們的市場推廣策略及(ix)當前市場價格。因此，我們的托盤及托盤相關產品的銷售價格差異很大，導致於往績記錄期間價格範圍廣泛。

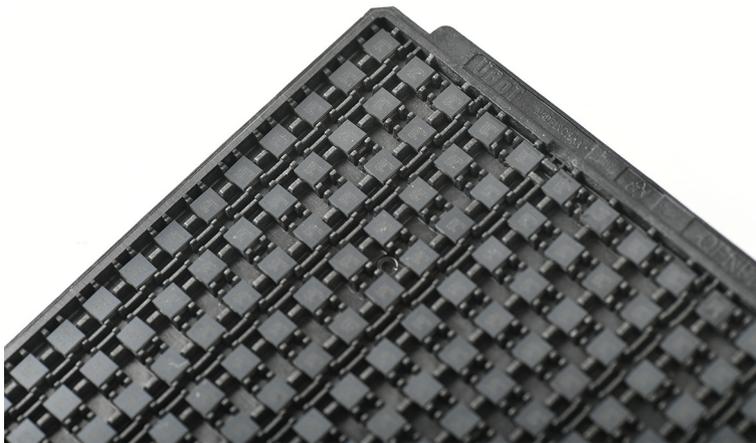
業 務

董事認為，本集團的托盤及托盤相關產品並無具體生命週期，因為我們的產品主要乃根據客戶的具體要求及商業需求為其開發的各種解決方案。因此，本集團的托盤及托盤相關產品及解決方案的生命週期取決於許多外部因素，如客戶的需求及偏好的變化，以及後段半導體傳輸介質以及半導體器件及電子產品行業的技術發展。

以下照片為本集團若干不同規格托盤及托盤相關產品的樣本：

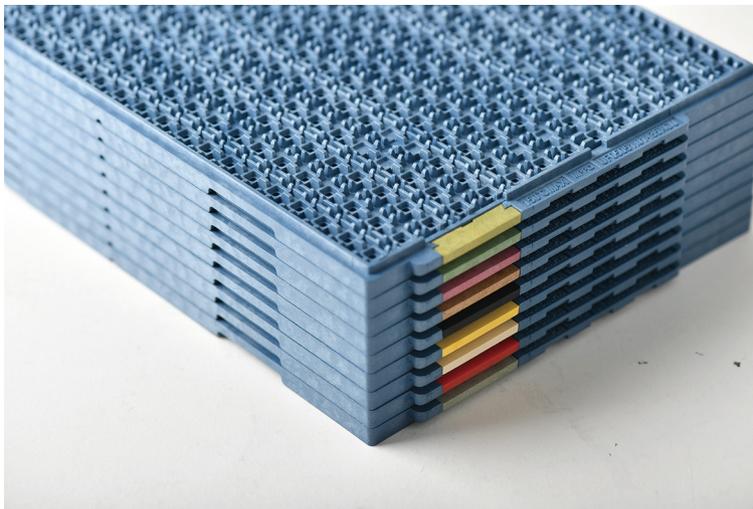


口袋大小55毫米x55毫米的可烘烤JEDEC托盤，以放置BGA設備
(附註：上圖置於托盤產品上的半導體設備並非本集團產品，僅供說明用途)



口袋大小5毫米x5毫米的可烘烤JEDEC托盤，
以放置我們的MEMS及感應器產品，僅供說明用途

業 務



我們的MEMS及傳感器封裝解決方案

MEMS及傳感器可於通訊、消費、工業及汽車領域的廣泛系統中運行，且可將MEMS同化為不同的應用組件，包括比頻器、壓力傳感器、麥克風、加速度計、陀螺儀、慣性元件、噴墨打印頭、光學器件等設備。MEMS設備通常集成微型傳感器、執行器及信號處理組件，能夠捕獲並處理測量溫度、氣壓、磁場及輻射等物理數據並對其進行處理，而傳感器為一種檢測物理屬性的裝置或系統，然後記錄及／或對刺激作出反應。

因此，MEMS及傳感器封裝為一個完整的操作程序，主要將各種電子及機械部件結構於一個外殼中，為整個製造的封裝提供一個與外部環境連接的手段。亦可保護芯片不受潛在外部因素的破壞及老化的腐蝕影響，並促進電氣連接及散熱。

業 務

於各封裝產品中，有各種MEMS與封裝的連接方案，如單晶粒線接或倒裝片接，多晶粒堆疊線接或倒裝片接。由MEMS加工及製造公司生產的MEMS芯片，一般通過導線鍵合或翻轉焊接工藝，與芯片附著材料及基片連接及互連。ASIC芯片通常需要用於低功率操作、信號處理等，因此封裝方案將MEMS及ASIC組裝於同一封裝。我們能夠為客戶制定複雜的MEMS及傳感器封裝解決方案，以幫助我們的客戶實現其MEMS及傳感器設備的預期功能。我們提供的服務包括(i) MEMS及傳感器外殼及／或模塊設計；(ii) MEMS及傳感器封裝結構設計及材料選擇；(iii) MEMS及傳感器封裝或模塊原型開發及工程批量服務；(iv) MEMS及傳感器封裝認證服務、製造工藝開發及批量製造服務；及(v) MEMS及傳感器封裝電氣測試及可靠性測試服務。我們的董事認為，我們的MEMS及傳感器封裝解決方案的訂單量取決於我們客戶的MEMS及傳感器設備於市場上的接納程度及受歡迎程度。我們的MEMS及傳感器封裝解決方案的產品生命週期，由消費市場應用的最短三至五年至工業市場應用的最長超過15至20年。

下表載列有關我們具有代表性的MEMS及傳感器封裝解決方案、其應用領域及價格範圍的若干資料。

產品	描述	於往績記錄期間的價格範圍
(1) 流量傳感器模塊 	<ul style="list-style-type: none">• 流量傳感器模塊用於測量氣體或液體的流量。• 產品尺寸：24 x 21毫米• 應用於過程控制和監測、油氣洩漏檢測、HVAC及空氣控制系統、CPAP及呼吸設備以及液體分配系統。	約38.8港元至59.0港元

業 務

產品	描述	於往績記錄期間的價格範圍
(2) 半密封傳感器封裝 (ERAQFN) 	<ul style="list-style-type: none">半密封傳感器封裝(ERAQFN)為一種外殼，用於保護執行氣體檢測及濃度測量、火焰檢測及運動檢測功能的傳感器免受腐蝕及／或物理損壞。產品尺寸：3.7 x 5.65毫米通過JEDEC標準認證。應用於氣體傳感、火焰檢測、食品及油類分析、運動檢測及手勢識別。	約4.3港元至8.6港元

載帶

捲帶包裝解決方案主要由載帶、塑膠捲盤及蓋帶組成。與我們的托盤類似，載帶及塑膠捲盤主要用作安全處理、運輸及存儲尺寸相對較小的半導體器件的保護性封裝，並防止半導體器件於出境運輸和入境存儲過程中受到物理及ESD影響。捲帶式包裝解決方案亦被設計用於將半導體器件送入自動貼片機，以便於電路板組件上進行表面貼裝並且可大大減少製造過程中的裝配停機時間。載帶上打有順序的獨立空腔，每個空腔可容納一個半導體器件，蓋帶密封在載帶上，將器件保留於空腔中，然後將其儲存於捲軸中，於處理及儲存期間提供機械保護。

我們的載帶及捲盤符合EIA標準，可用於所有SMT封裝。EIA標準為電子元件及系統的元件標記、數據建模、顏色編碼及封裝材料提供指導，其中亦規定引線數量、載帶寬度、載帶間距、元件方向以及腔和捲軸的尺寸等。與托盤的功能不同，載帶和捲軸用於固定尺寸相對較小的半導體器件。與托盤相比，更多半導體器件可以被儲存於載帶中。由於載帶及捲軸的配置通常用於表面貼裝工藝，比托盤更適用於大規模生產。載帶及捲軸的重量一般亦較輕，將有效地降低運輸成本。

業 務

我們的董事認為，本集團的載帶產品並無特定生命週期，是由於我們的產品主要乃根據客戶的特定要求及商業需求為客戶開發各種解決方案。因此，本集團載帶產品及解決方案的生命週期取決於多項外部因素，例如客戶的需求和偏好變化，以及後段半導體傳輸介質以及半導體器件和電子產品行業的技術發展。

以下照片顯示本集團若干載帶產品：



不同寬度的載帶



包含我們的MEMS及感應器封裝產品的
寬度為16毫米的載帶，僅供說明用途



寬度為12毫米的載帶

業 務



包含我們的MEMS及感應器封裝產品的
寬度為16毫米的載帶，僅供說明用途

我們的MEMS及傳感器封裝解決方案及載帶的售價取決於(i)產品類型、複雜程度及設計；(ii)客戶指定的材料及規格；(iii)材料混合成本；(iv)生產成本；(v)產品功能；(vi)同一採購的訂單數量；(vii)涉及客戶的細分市場；(viii)我們的市場推廣策略；及(ix)現行市場價格。因此，我們主要產品的售價差異很大，導致往績記錄期間價格範圍廣泛。有關我們定價政策的進一步詳情，請參閱本節「客戶－定價政策及信用條款」一段。

季節性

我們的銷售業績受季節性影響。除接近農曆新年假期時間，我們一般於全年錄得相對穩定的銷售收入。部分客戶於亞洲建立生產基地或組裝廠。由於農曆新年通常為亞洲(尤其是中國)的淡季，客戶一般會於農曆新年假期前下達訂單，是由於大部分製造工人將於此期間停止工作。因此，對產品的需求於春節假期前普遍較高，而於春節假期期間普遍較低。因此，我們於二零二零年及二零二一年第一季度分別錄得約36.0百萬港元及約44.3百萬港元的銷售收入，以及於二零二零年及二零二一年最後季度分別錄得約46.0百萬港元及約58.0百萬港元的銷售收入。另一方面，半導體供應商經常會出現不定期的收入波動，因此我們全年的銷售表現可能會不時變化。

業 務

研發

我們致力於提供符合客戶及市場偏好及要求的可靠產品。為迎合客戶新的規格及要求以及實施產品升級的需要，我們需要不斷構思及發明新的產品配方，以應對最新的市場和產品趨勢，從而提高競爭對手競爭或模仿我們的產品的進入門檻。此外，我們致力多元化我們的產品供應範圍，並通過研發探索產品應用的新領域，以利用行業內的最新技術發展並鞏固我們的市場地位。由於在每個連續製造步驟中均會為半導體器件增加重要價值，因此必須小心及精確地處理半導體器件以最大限度地減少損壞。客戶依靠我們的產品通過保護半導體器件於製造過程中免受退化、磨損及污染以提高產量。因此，高度可靠的界面尺寸及具有關鍵特性(如熱阻及ESD特性)的先進材料對於高質量的後段半導體傳輸介質至關重要。因此，我們亦利用我們積累的行業知識及材料工程專業知識及專有技術，不斷開發和改進我們的材料複合配方和應用，以有效地將我們的研發目標對準滿足客戶製造要求的產品。因此，我們相信我們的研發能力對於我們於後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案行業的持續成功至關重要。

於開發新的後段半導體傳輸介質及／或MEMS及傳感器封裝解決方案時，我們與客戶保持積極溝通，以確保開發中的產品接近所要求的規格。研發過程為一項集體貢獻，我們的銷售及市場推廣人員、研發及材料工程部、製造部及質量保證部相互密切合作，以實現開發中的產品。為促進與客戶的溝通，我們定期召開開發會議討論及審查開發計劃的細節，並生產及提交原型供彼等檢查及測試。有關進一步詳情，請參閱下文「研發計劃」。

於最後實際可行日期，研發及材料工程部分別由28名員工組成，由材料工程總監Wang Huimin博士(主要負責後段半導體傳輸介質的產品開發及材料工程)及我們的研發負責人Kenneth Kwan先生(主要負責MEMS及傳感器封裝解決方案的產品開發)領導。Wang博士獲取中國西北工業大學材料科學工學學士及工程碩士學位以及中國浙江大學哲學博士學位，於分子設計和材料設計及製造技術以及材料性能和壽命預測方面擁有超過24年經驗。Kenneth Kwan先生畢業於英國伯

業 務

明翰大學，獲得工程學學士學位，於行內積累超過25年經驗。有關其履歷的詳細資料，請參閱本文件「董事及高級管理層－高級管理層」。

於最後實際可行日期，反映本集團的研發努力，我們已於中國、美國及香港取得15項專利。有關更多詳情，請參閱下文「知識產權」。

於往績記錄期間，本集團已完成16個研發項目，主要旨在(i)擴大我們的產品組合；(ii)提高產品質量；(iii)改善製造流程。下表載列於往績記錄期間進行的部分主要研發項目：

研發項目 編號	研發項目 類別	研發項目	項目描述	項目		投資金額 (港元) (概約)
				開始日期	項目狀況	
托盤及托盤相關產品						
1.	擴大產品 組合	MPPO-CNT托盤製 造技術	開發新一代超潔淨、輕量 化及ESD保護更佳的托 盤。	二零二一年 三月	已完成	287,417
2.	擴大產品 組合	潔淨室應用裸芯片 托盤的設計與製 造技術	設計和開發貼有一層特殊 膠帶的裸芯片托盤，該 膠帶對溫度敏感，以方 便半導體器件的拾取過 程	二零二零年 三月	已完成	172,912
MEMS及傳感器封裝解決方案						
3.	擴大產品 組合	裸片QFN/DFN 封裝	應用於液體流量應用的 流量傳感器模塊。使用 EMC材料保護傳感芯 片，材料足夠堅固，可 通過客戶指定的嚴格壓 力測試。	二零二零年 七月	正在進行	1,370,000

業 務

編號	研發項目		項目描述	項目		投資金額 (港元) (概約)
	類別	研發項目		開始日期	項目狀況	
4.	擴大產品 組合	消費版(低價版)半 密封傳感器封裝 (ERAQFN)	為ERAQFN封裝的低成本 版，面向消費市場。採 用EMI屏蔽塑膠蓋或蓋 子為產品提供更好的電 氣性能。	二零二一年 一月	正在進行	825,000
載帶						
5.	擴充產品 組合	載帶上的激光打標	於每個載帶口袋分隔脊上 激光標記二維碼。將能 夠根據標記的二維碼對 載帶中的集成芯片進行 單獨識別及追蹤。激光 打標設備將與自動攝像 頭檢測、標記驗證及反 饋、自動送料機構及聲 音警報系統相結合，以 指示不合格品。	二零二一年 一月	正在進行	780,000
6.	提高產品 質量， 改善製 造工藝	載片擠出	使用現有旋轉成型機的 擠出機載片。載片將被 切割成各種寬度，用於 在平板成型機上生產載 帶。將使材料定制能夠 滿足每個客戶的偏好並 實現更高的成本效益。	二零二一年 八月	正在進行	78,000

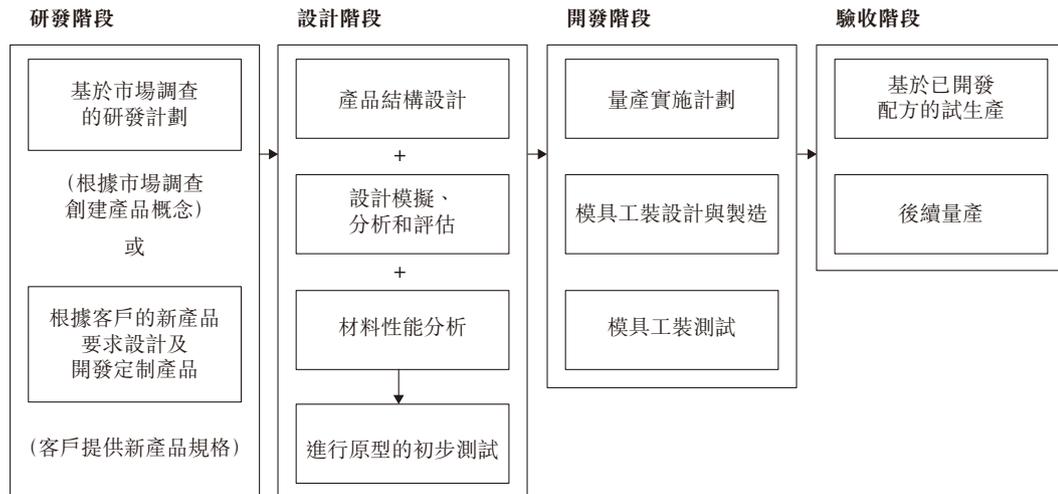
截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，我們的研發開支分別為4.6百萬港元、4.1百萬港元及3.1百萬港元。主要包括研發人員的工資及材料成本、測試費用、水電費以及用於研發活動的機器和設備的折舊費。

業 務

研發流程

新產品

以下為說明我們典型的新產品研發計劃研發過程的流程圖：



研究階段

研究階段通常開始於(i)自行發起的市場研究，主要目標為開發新的後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案，以擴大我們的客戶群並提高我們的盈利能力，或(ii)接收客戶有關設計及開發定制產品的新產品要求。我們主動尋求客戶反饋及廣泛研究，及時瞭解最新市場趨勢。我們認為，我們的市場意識及經驗對產品設計及開發特別有用。於自主研發方面，我們開展利用製造MPPO(碳納米管)托盤的技術研發項目，可提高托盤的ESD保護及潔淨化。有關新產品預計將於二零二二年年年底推出。我們亦開展消費版半密封傳感器封裝(ERAQFN)的研發項目，預計將於二零二三年推出。對於客戶發起的研發，本集團已能夠開發廣泛的後段半導體傳輸介質及MEMS及傳感器封裝解決方案，並於產品設計及建模方面與客戶密切合作。例如，我們與客戶共同開發用於潔淨室的裸芯片托盤，此乃層壓有一層對溫度敏感的特殊膠帶，以方便半導體器件的拾取過程。

業 務

設計階段

於產品設計及開發階段開始後，我們將於指定時間框架內製定我們的產品開發計劃，該計劃將為包括交付產品設計、原型、成型及試生產在內的每個步驟制定初步時間表。雖然我們通常承擔與產品設計及開發相關的所有成本，但此類成本通常會計入產品價格。我們相信，我們於產品設計及開發方面的持續努力將使我們能夠保持可持續增長，並有助於提高我們的利潤率。

研發及材料工程部負責開發產品的概念設計，而銷售及市場推廣人員將與客戶保持定期聯繫，於客戶發起的研發下討論其要求及偏好。於整個產品設計及開發過程中，我們與客戶密切合作，以微調設計、材料及技術規格，以改善產品特性及功能。開發思路可由我們發起，而無需客戶的任何初步投入，客戶將向我們提供其產品的基本規格，以供我們進一步開發。我們的產品設計及開發專家致力於探索技術進步，以提高產品質量、功能和降低生產成本。

於自主研發方面，根據市場調研結果，研發及材料工程部將分別進行新產品結構設計及材料性能分析。對於客戶發起的研發，研發及材料工程部將根據客戶的規格對產品進行設計模擬、結構分析及材料特性分析，並進行產品及材料方程式設計。然後生成2D及3D設計模擬報告，並由研發及材料工程部、製造部及質量保證部進行內部審查。於內部審查程序後，產品設計將提交予客戶進行評估及批准。於客戶批准及／或對產品設計進行內部分析及評估後，我們將生產原型並對原型進行初步測試。

開發階段

根據客戶提出的設計及開發計劃及／或建議，我們的研發及材料工程部將進行三步開發，包括(i)項目實施計劃；(ii)模具設計及製造；及(iii)模具測試。三步開發為一個不斷試錯的過程，旨在識別及消除潛在錯誤，並不斷評估、評估及改進開發中的產品。於整個開發階段，我們的研發及材料工程部將積極與客戶溝通及協調。我們的研發及材料工程部與各部門之間亦將進行初步詢問、內部討論及評估，相互交流，交流發展思路及研究角度。

業 務

驗收階段

一旦客戶確認設計符合要求及／或於市場上推出，開發的產品配方將獲最終確定並轉交予我們的行政及營運支援部、製造部及質量保證部進行原材料採購、庫存計劃及生產計劃。於新產品量產前，我們的研發及材料工程部會與製造部確認製造計劃及技術規格，以確保產品符合所需的設計及標準，並保持一致的產品質量。我們的行政及營運支援部、製造部及質量保證部隨後將根據開發的產品配方開始批量生產。

材料及製造工藝改進

我們的研發工作不僅專注於提供廣泛而深入的先進及差異化產品設計組合，我們亦將研發工作投入至材料改進以及靈活及適應性製造技術上，以實現成本效益及提升材料表現。我們的研發及材料工程部將對該等配方進行材料配方設計及成本分析。然後，我們的研發及材料工程部將對所配製的材料進行性能測試及成分分析，以改良該配方。配方改良後，我們的研發及材料工程部將進行注塑成型的材料複合工藝，並隨後進行性能測試及評估，包括但不限於標準桿測試及注塑托盤測試。最終，如配製的材料通過成本評估，我們將開始大規模生產配製的材料。除材料改進的研發，我們亦進行不同的研發項目，以改善我們的製造工藝，包括但不限於載體片材擠壓。

生產

我們的生產廠房

於最後實際可行日期，我們經營兩個生產廠房，(i)沙田生產廠房；及(ii)厚街生產廠房。我們的沙田生產廠房主要負責托盤及托盤相關產品、載帶及MEMS及傳感器封裝解決方案的整個生產過程，而厚街生產廠房則專注於托盤及托盤相關產品的注塑成型工藝。我們的厚街生產廠房配備先進的生產機械，包括高精度注塑機、機械臂、除濕機及機邊流道破碎機，以自動化提高生產效率。此外，沙田生產廠房配備潔淨室設施，使MEMS及傳感器封裝解決方案的基本生產階段（如芯片貼裝、引線鍵合、高功率顯微鏡檢查及環氧樹脂固化）能夠於一個一致及清潔的環境進行。我們定期檢查潔淨室內的空氣質量，以確保潔淨室設施正常運行。

業 務

下文載列於最後實際可行日期我們的生產廠房詳情：

生產廠房	地點	生產 廠房數量 ⁽¹⁾	開始營運	概約總建築 面積 (平方米)
沙田生產廠房	東莞市沙田鎮成田路17號 1號樓及3號樓	3	二零一零年	9,254
厚街生產廠房	東莞市厚街鎮環岡村白山頭 地段內C棟	1	二零二一年	7,835

- ⁽¹⁾ 本文中每套生產設施乃指我們於中國的每個生產廠房用於製造我們各類別產品的所有機器及設備，該等產品為我們的(i)托盤及托盤相關產品，(ii) MEMS及傳感器封裝解決方案，及(iii) 載帶產品。

沙田生產廠房

我們的沙田生產廠房位於中國廣東省東莞市沙田鎮成田路17號1號樓及3號樓，擁有3個生產設施，各自分別專門生產托盤及托盤相關產品、MEMS及傳感器封裝解決方案以及載帶產品。於最後實際可行日期，沙田生產廠房的總建築面積約為9,254平方米，擁有333名工人。

厚街生產廠房

我們的厚街生產廠房位於中國廣東省東莞市厚街鎮環岡村白山頭地段內C棟，擁有1個生產設施，專門從事托盤及托盤相關產品的注塑加工。於最後實際可行日期，厚街生產廠房的總建築面積約為7,835平方米，擁有59名工人。

有關我們物業的進一步詳情，請參閱本節「物業」一段。

業 務

生產能力及利用率

廠房	最大產能 ^(附註1)			實際產量			利用率 ^(附註2)		
	截至			截至			截至		
	二零二二年			二零二二年			二零二二年		
	截至十二月三十一日止年度		六月三十日	截至十二月三十一日止年度		六月三十日	截至十二月三十一日止年度		六月三十日
	二零二零年	二零二一年	止六個月	二零二零年	二零二一年	止六個月	二零二零年	二零二一年	止六個月
	^(附註3)								
托盤及托盤相關(單位)									
沙田生產廠房	25,482,600	26,282,000	8,020,000	24,033,600	25,080,728	7,433,410	94.3%	95.4%	92.7%
厚街生產廠房	不適用	6,623,900	8,137,700	不適用	5,925,900	7,892,640	不適用	89.5%	97.0%
載帶(米)									
沙田生產廠房	6,933,005	6,933,005	3,466,502	846,200	695,000	480,600	12.2%	10.02%	13.9%
MEMS及傳感器產品封裝解決方案									
(流量傳感器模塊)(單位)									
沙田生產廠房	12,000	12,000	6,000	2,553	10,702	2,500	21.3%	89.2%	41.7%
MEMS及傳感器產品封裝解決方案									
(半密封傳感器封裝(ERAQFN))									
(單位)									
沙田生產廠房	180,000	180,000	90,000	175,275	67,800	50,000	97.4%	37.7%	55.6%

附註1 最大生產能力的計算基於以下假設：

- (i) 就托盤及托盤相關產品而言，我們生產廠房的相關生產設施使用(1)每天24小時及(2)每月26天。
- (ii) 就載帶產品而言，我們生產廠房的相關生產設施使用(1)每天12小時及(2)每月24天生產寬度為24毫米的載帶。據董事所稱，生產載帶產品需要更多技術熟練的工人，惟他們不願意上夜班，因此每天只能進行12個小時的生產。
- (iii) 關於MEMS及傳感器產品封裝解決方案(流量傳感器模塊及ERAQFN)，我們生產廠房的相關生產設施使用(1)每天12小時及(2)每月24天。據董事所稱，生產MEMS及傳感器封裝解決方案需要更多技術熟練的工人，惟他們不願意上夜班，因此每天只能進行12個小時的生產。

附註2 各項利用率乃按實際產量除以百分比水平呈列的相關最大產能計算。

附註3 鑑於農曆新年假期，一月至六月的工作日一般少於七月至十二月。

業 務

自二零二零財年至二零二一財年，我們生產廠房的托盤及托盤相關產品的最大產能增加7,423,300個單位，主要歸因於(i)部分升級生產設施以促進沙田生產廠房自動化，以及(ii)厚街生產廠房於二零二一年六月投產。

我們的生產廠房於二零二零財年及二零二一財年的托盤及托盤相關產品利用率呈上升趨勢，主要是由於我們的客戶於二零二零財年至二零二一財年的採購訂單增加，與我們於該期間的收入增加基本一致。對於我們的載帶產品，由於載帶僅為我們於二零一九年推出的新產品，我們於往績記錄期間的利用率相對較低。此外，半導體公司通常需要對其供應商進行現場工廠審核，並於下訂單前對後段半導體傳輸介質的任何新產品進行資格及批准。但是，於COVID-19及相關旅行限制實施下，我們的客戶於下訂單前，(i)我們的技術工程師很難訪問我們的客戶以進行資格程序和機器調整過程，以及(ii)很難進行現場審核過程。因此，於往績記錄期間，我們向兩名主要客戶(包括STMicroelectronics及客戶D)提交三類載帶產品，其於往績記錄期間亦有購買我們的托盤及托盤相關產品。儘管如此，我們預計未來將有更多客戶使用載帶。於最後實際可行日期，我們已接獲現有或潛在客戶對載帶產品的查詢，其中部分為於往績記錄期間亦有購買我們的托盤及托盤相關產品的主要客戶。我們沙田生產廠房的流量傳感器模塊於二零二零財年及二零二一財年的使用率顯著上升，主要是由於來自一間總部位於日本，從事開發設計、製造及銷售半導體產品的公司的訂單量增加。二零二零財年及二零二一財年沙田生產廠房半密封傳感器封裝(ERAQFN)的使用率下降，主要是由於一間於納斯達克上市，主要從事設計、開發及供應半導體及基礎建設軟件解決方案的公司的原材料供應短缺導致其訂單量減少。

為提高整個生產過程的自動化水平，以及滿足我們客戶預期不斷增長的需求，並進一步擴大我們的業務以抓住未來機會，我們計劃通過升級我們於中國的生產設施以提高我們的產能及能力，並於菲律賓實施載帶的生產。有關我們擴張計劃的詳情，請參閱本節「業務戰略—通過促進生產過程的自動化、升級生產設施及購買必要的機器以提高我們的產能和能力」。

業 務

我們生產過程中使用的主要機器及設備

於最後實際可行日期生產過程中涉及的機器及設備詳情載列如下：

機械／設備	用法	概約 單位數量	概約 平均剩餘 使用壽命	概約 平均年齡
<i>用於托盤及托盤相關產品</i>				
注塑機	使用模具執行成型過程。塑膠材料被加熱熔化，然後送入模具冷卻，形成指定的形狀。	46	10年	9年
機械臂	從模具中取出固化的托盤產品，將托盤產品安全準確地放置並堆放在收集傳送帶上，隨後從模具中取出流道並放入側破碎機中重新給料回料斗，以節省人力成本及材料成本。	24	15年	1年
除濕機	將乾燥後的塑膠材料以精確控制的間隔及劑量送入注塑機的料斗前，乾燥或去除配方托盤材料中的水分，以確保材料表現穩定。	30	15年	1年
破碎機	以適當的力量壓縮及壓碎靜止的熱流道，並立即重新送回料斗，以防止產生碎屑和顆粒，從而提高材料產量。	21	15年	1年

業 務

機械／設備	用法	概約 單位數量	概約 平均剩餘 使用壽命	概約 平均年齡
用於載帶				
擠出機單位	在受控環境中融化配製的聚合物並以熔融形式擠出，用於載體成型工藝。	2	10年	2年
成型模塊	使用旋轉真空模具將載帶片材形成所需的口袋設計。	2	10年	2年
沖孔模塊	使用機械沖孔模組於載帶片材上沖出所需的孔。	2	10年	2年
分切模塊	修剪多餘的載片邊緣材料，並將載片切成所需的寬度，裝入載帶。	2	10年	2年
視覺檢測系統	使用安裝的相機檢查系統檢查每個單獨的載帶袋的尺寸及表面外觀。當任何載帶袋超出尺寸規格時，警報將自動激活。	3	10年	2年
繞線模塊	根據所需的長度及捲繞張力將載帶捲繞成大捲軸。	2	10年	2年

業 務

機械／設備	用法	概約		
		概約 單位數量	平均剩餘 使用壽命	概約 平均年齡
<i>用於MEMS及傳感器封裝解決方案</i>				
注塑機	使用模具執行成型過程。塑膠材料被加熱熔化，然後送入模具冷卻，形成指定的形狀。	1	20年	11年
點膠機	用於粘接、密封、灌封、封裝、絕緣等各種環氧樹脂的大批量、自動和精密點膠工藝。	1	20年	5年
貼片機	通過預塗環氧樹脂將管芯或芯片連接到基板或引線框架或封裝上	2	20年	15年
銲線機	用於使用鍵合線於半導體(或其他IC)及矽芯片之間建立電氣互連的線鍵合，鍵合線乃由金等材料製成的細線。	5	20年	16年
包覆成型機	用於轉移成型。封閉式模具系統可減少橡膠從型腔中逸出並限制多餘的飛邊。於該過程開始前，測量適量的成型材料，插入然後放入成型罐中。	1	20年	11年

於往績記錄期間，我們擁有生產過程中涉及的主要機器及設備。於往績記錄期間，我們向獨立第三方購買生產機器及設備。

於往績記錄期間，我們於沙田生產廠房及厚街生產廠房共有11名員工，負責生產機械設備的維修及定期維護。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無因機器及設備故障或故障而導致生產過程延長暫停或業務營運出現重大中斷。

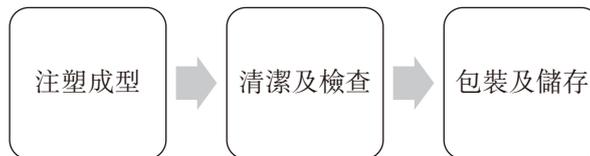
業 務

有關我們機器設備折舊方法的詳情，請參閱本文件「財務資料－主要會計政策－物業、廠房及設備」一段。

我們的生產過程

托盤及托盤相關產品

收到客戶的採購訂單後，我們開始生產階段。以下流程圖顯示我們的托盤及托盤相關產品的生產過程中通常涉及的主要步驟：



於生產過程開始前，我們會根據按客戶要求及擬定用途得出的指定材料方程式進行材料準備工作，包括樣品準備、混合、混合及材料測量，以及涵蓋各種不同特性的工程材料，例如不同額定溫度、ESD特性、顏色、機械強度和清潔度水平的組合。材料的水分含量亦根據材料質量要求進行控制。此外，我們會於生產前進行模具檢查，包括口袋檢查、尺寸測量、模芯狀態及模具組裝。有關我們托盤及托盤相關產品規格的進一步詳情，請參閱本節「我們的產品－我們的托盤及托盤相關產品」一段。

關鍵步驟	描述	所需時間
1. 注塑成型	設置參數，包括料筒溫度、模具溫度和保壓壓力等。	根據產品的規格，例如產品重量和結構，注塑所需的時間從20秒到45秒不等。

業 務

關鍵步驟	描述	所需時間
2. 清潔及檢查	對托盤及托盤相關產品進行清潔度控制及檢查的後工序，包括(i)吹氣清潔托盤表面，(ii)目視檢查以確保產品完整性及(iii)對不同特性和功能的功能檢查，如表面電阻測試及烘烤測試。	對於自動清潔，每件大約需要3至5秒。 對於檢驗過程，外觀檢查每批樣品大約需要80分鐘，功能檢查每批樣品大約需要20分鐘。
3. 包裝及儲存	產品於入庫前被包裝並封裝至定制設計的包裝盒中，並貼上產品標籤。	每批產品大約需要6至10分鐘進行標籤打印。

載帶

以下流程圖顯示我們載帶生產過程中通常涉及的主要步驟：



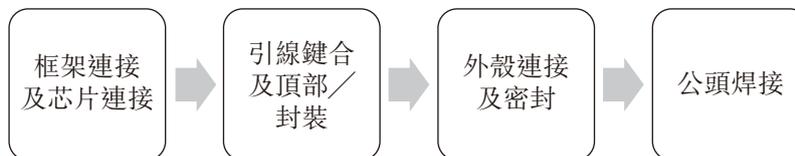
關鍵步驟	描述	所需時間
1. 擠壓	塑膠原料被混合、加熱、熔化並以熔融形式擠出到成型模塊以進行載體成型過程。	<ul style="list-style-type: none"> • 寬度為24毫米的載帶的平均成型速度約為每分鐘8至10米。
2. 成型	旋轉成型應用真空技術在載帶片上形成所需設計的口袋。	

業 務

關鍵步驟	描述	所需時間
3. 沖孔	在載帶片的口袋及側面上打出指定的孔。	
4. 分切	根據規格將載帶片切成所需的載帶寬度。	
5. 視覺檢測	單個載帶袋的尺寸及表面外觀由視覺相機系統檢查。	
6. 繞組	載帶纏繞成帶有標籤標識的巨型捲軸。	
7. 包裝及儲存	產品經包裝後裝入紙箱並貼上產品標籤後入庫。	

MEMS及傳感器封裝解決方案

以下流程圖顯示流量傳感器模塊生產過程中通常涉及的主要步驟：



業 務

流量傳感器模塊

關鍵步驟	描述	所需時間
1. 框架連接及芯片連接	框架通過粘合劑環氧樹脂連接至PCB上，以形成用於芯片連接的空腔，並用作流量傳感器外殼的底座。然後通過粘合劑環氧樹脂將傳感芯片連接至PCB的空腔中。	每個單位大約3.3分鐘。
2. 引線鍵合及頂部／封裝	傳感器芯片及PCB之間用金線互連。然後將管芯封裝於空腔中，並用環氧樹脂封裝導線以保護其免受損壞。	每個單位大約3.0分鐘。
3. 外殼連接及密封	塑膠外殼連接於PCB上，外殼外圍由粘合劑環氧樹脂密封。	每個單位大約0.9分鐘。
4. 公頭焊接	金屬引腳通過焊料連接至PCB作為連接器。	每個單位大約1.4分鐘。

業 務

半密封傳感器封裝(ERAQFN)

以下流程圖顯示我們的半密封傳感器封裝(ERAQFN)生產過程中通常涉及的主要步驟：



關鍵步驟	描述	所需時間
1. 芯片連接	MEMS及ASIC芯片通過粘合劑環氧樹脂連接到腔體單元上。	每個單位大約0.2分鐘。
2. 引線鍵合	傳感器芯片及PCB之間用金線互連。	每個單位大約0.2分鐘。
3. 過濾器連接、蓋連接及密封	過濾器通過粘合劑環氧樹脂連接到金屬蓋上，金屬蓋連接於空腔單元上並通過粘合劑環氧樹脂密封。	每個單位大約3.2分鐘。

我們的中國法律顧問確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面遵守中國所有適用的安全生產法律及法規。

業 務

質量控制

通過實施全面的質量控制體系，我們非常重視我們的產品質量。我們的質量控制措施範圍涵蓋我們生產過程的大部份，由原材料採購至封裝。我們保留一份質量控制手冊，該手冊已參考JEDEC、EIA、RoHS、REACH標準及適用的行業標準的要求編製。於最後實際可行日期，我們的質量保證部由超過39名員工組成，均駐紮於我們的沙田生產廠房及厚街生產廠房。

對於原材料，我們主要由我們內部批准名單上的供應商採購材料，該名單會定期審查。管理層將至少每年一次確認及檢查獲批准供應商提供的材料的質量，以確保我們的原材料質量穩定。我們的質量保證部亦會根據我們的質量控制手冊對交付至我們生產廠房的原材料進行抽樣測試。當我們為客戶定制托盤及托盤相關產品時，我們會根據客戶於溫度等級、ESD概況及機械強度等方面的具體要求開發複雜的材料配方。於根據特定的材料配方對塑料材料進行混合及攪拌前，我們會由進貨材料中取樣，並根據ASTM標準對材料的特性進行測量及測試，以確定進貨材料是否符合基於技術要求的進貨驗收標準，以確定材料的指定特性可以適當地執行。我們通常會將任何不合格及有缺陷的材料退回供應商進行更換。董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無發生對我們的生產計劃造成重大影響的重大更換事件。

於生產過程中，質量保證部需要於每個生產步驟進行各種檢查和檢查。除內部質量控制手冊，質量保證部將確保產品符合客戶的規格。質量控制的主要測試包括表面電阻測試、彎曲測試、捆紮測試、堆疊測試、凹凸測試及烘烤測試等。質量保證部需於生產過程中對工件進行逐件抽樣的全面測試。

對於成品，我們的質量保證部將於整個生產過程完成後對我們的產品進行最終檢查。彼等將檢查封裝的成品，以確保無材料缺陷，並按照相關客戶的要求進行封裝。

董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，並無發生對我們的業務營運造成重大不利影響的質量控制系統失靈事件。

業 務

客戶

本集團的大部分銷售額來自於全球，尤其是東南亞、中國及台灣的托盤及托盤相關產品的銷售，因此我們的客戶基礎廣泛。除東南亞、中國和台灣市場，我們還在歐洲、美國、韓國和日本建立了銷售網絡。截至二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度各年，我們分別向超過100位客戶銷售我們的產品。大多數客戶為全球IDM公司、無晶圓廠半導體公司及IC組裝及封裝測試機構。

下表載列我們於往績記錄期間按地區劃分的收入明細：

	十二月三十一日止年度				截至六月三十日止六個月			
	二零二零年		二零二一年		二零二一年		二零二二年	
	估總數		估總數		估總數		估總數	
	收入	的百分比	收入	的百分比	收入	的百分比	收入	的百分比
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%
	(未經審核)							
東南亞	63,808	38.4	72,219	35.6	34,944	38.2	38,409	31.9
中國	32,880	19.8	55,495	27.3	22,972	25.0	33,117	27.5
台灣	33,924	20.4	39,195	19.3	17,290	18.9	28,828	23.9
美國	17,798	10.7	16,782	8.3	6,914	7.5	11,240	9.3
歐洲	3,896	2.3	3,433	1.7	1,970	2.2	2,274	1.9
香港、韓國及日本	13,673	8.2	15,824	7.8	7,498	8.2	6,636	5.5
合共	<u>165,979</u>	<u>100.0</u>	<u>202,948</u>	<u>100.0</u>	<u>91,588</u>	<u>100.0</u>	<u>120,504</u>	<u>100.0</u>

憑藉我們在行業內超過15年的經營歷史，我們憑藉良好的聲譽積累龐大的固定客戶群。於往績記錄期間，我們的主要客戶已向本集團購買產品超過10年。

業 務

主要客戶

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，我們於各年度／期間的五個最大客戶分別佔我們總收益的約63.7%、60.9%及57.3%，而我們各年度／期間的最大客戶佔相關期間的總收益約21.2%、20.6%及20.5%。下表載列於往績記錄期間我們的前五名客戶的簡要資料：

		截至二零二零年十二月三十一日止年度						
排名	客戶	我們提供的 主要產品	與本集團 多年的 業務關係	客戶商業活動	收入貢獻 (千港元) (概約)	我們 總收入 的概約 百分比	信貸期	付款方法
1	客戶A	托盤及托盤相關 產品	16年	一家於台灣註冊成立並於台灣證券交易所及紐約證券交易所上市的公司的附屬公司，該公司為一家半導體組裝及測試服務供應商。本集團與客戶A的11家附屬公司有業務關係。	35,157	21.2%	少於45日	通過電匯
2	客戶B	托盤及托盤相關 產品	11年	一家於美國註冊成立並在納斯達克上市的公司，連同其附屬公司，主要從事電腦內存及電腦數據存儲的製造、設計及銷售。於各年度／期間，本集團與客戶B的6家附屬公司有業務關係。	21,115	12.7%	60日	通過電匯
3	STMicroelectronics	托盤及托盤相關 產品及載帶	15年	一間總部位於瑞士，於紐約證券交易所上市的公司附屬公司，主要從事為汽車、工業、個人電子及通信設備、計算機及外圍設備市場提供半導體解決方案。本集團與STMicroelectronics的5家附屬公司有業務關係。	20,917	12.6%	約50日	通過電匯
4	客戶C	托盤及托盤相關 產品	12年	上海證券交易所上市公司從事集成電路開發的附屬公司。本集團與客戶C的4家附屬公司有業務關係。	17,643	10.6%	45日	通過電匯
5	客戶D	托盤及托盤相關 產品及載帶	13年	一家總部位於美國並於納斯達克上市的公司及其附屬公司，主要從事設計、製造、測試及營銷廣泛的解決方案組合，包括IC、軟件和子系統。本集團與客戶D的9家附屬公司有業務關係。	10,922	6.6%	30日	通過電匯

業 務

截至二零二一年十二月三十一日止年度

排名	客戶	我們提供的 主要產品	與本集團 多年的業 務關係	客戶商業活動	收入貢獻 (千港元) (概約)	我們 總收入 的概約 百分比	信貸期	付款方法
1	客戶A	托盤及托盤相關 產品	16年	一家於台灣註冊成立的公司的附屬公司，該公司於台灣證券交易所及紐約證券交易所上市，為一家半導體組裝及測試服務供應商。本集團與客戶A的11家附屬公司有業務關係。	41,777	20.6%	少於45日	通過電匯
2	客戶C	托盤及托盤相關 產品	12年	一家於上海證券交易所上市及從事集成電路開發的公司的附屬公司。本集團與客戶C的4家附屬公司有業務關係。	24,094	11.9%	45日	通過電匯
3	客戶B	托盤及托盤相關 產品	11年	一家於美國註冊成立並在納斯達克上市的公司，連同其附屬公司主要從事電腦內存及電腦數據存儲的製造、設計及銷售。本集團與客戶B的6家附屬公司有業務關係。	20,750	10.2%	60日	通過電匯
4	STMicroelectronics	托盤及托盤相關 產品及載帶	15年	STMicroelectronics N.V.的附屬公司，總部位於瑞士，於紐約證券交易所上市，主要從事為汽車、工業、個人電子及通訊設備、電腦及外圍設備市場提供半導體解決方案。本集團與STMicroelectronics的6家附屬公司有業務關係。	20,454	10.1%	約50日	通過電匯
5	客戶D	托盤及托盤相關 產品、載帶及 MEMS及傳感 器封裝解決 方案	13年	一家總部位於美國並於納斯達克上市的公司及其附屬公司，主要從事設計、製造、測試及營銷廣泛的解決方案組合，包括IC、軟件和子系統。本集團與客戶D的10家附屬公司有業務關係。	16,451	8.1%	30日	通過電匯

業 務

截至二零二二年六月三十日止六個月

排名	客戶	我們提供的 主要產品	與本集團 多年的業 務關係	客戶商業活動	收入貢獻 (千港元) (概約)	我們 總收入 的概約 百分比	信貸期	付款方法
1	客戶A	托盤及托盤相關 產品	16年	一家於台灣註冊成立的公司的附屬公司，該公司於台灣證券交易所及紐約證券交易所上市，為一家半導體組裝及測試服務供應商。本集團與客戶A的11家附屬公司有業務關係。	24,720	20.5%	少於45日	透過電匯
2	客戶B	托盤及托盤相關 產品	11年	一家於美國註冊成立並在納斯達克上市的公司，連同其附屬公司主要從事電腦內存及電腦數據存儲的製造、設計及銷售。本集團與客戶B的6家附屬公司有業務關係。	13,238	11.0%	60日	透過電匯
3	客戶C	托盤及托盤相關 產品	12年	一家於上海證券交易所上市及從事集成電路開發的公司的附屬公司。本集團與客戶C的4家附屬公司有業務關係。	12,007	10.0%	45日	透過電匯
4	STMicroelectronics	托盤及托盤相關 產品以及載帶	15年	一家總部位於瑞士及於紐約證券交易所上市的公司的附屬公司，主要從事為汽車、工業、個人電子及通訊設備、電腦及外圍設備市場提供半導體解決方案。本集團與STMicroelectronics的7家附屬公司有業務關係。	9,579	7.9%	約50日	透過電匯
5	客戶D	托盤及托盤相關 產品、載帶及 MEMS及傳感 器封裝解決方 案	13年	一家總部位於美國並於納斯達克上市的公司及其附屬公司，主要從事設計、製造、測試及營銷廣泛的解決方案組合，包括IC、軟件和子系統。本集團與客戶D的10家附屬公司有業務關係。	9,497	7.9%	30日	透過電匯

據本公司董事所知，於往績記錄期間，五大客戶全部均為獨立第三方，且本公司董事或其聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何股東均未於本集團的任何五大客戶中擁有任何權益或於過往或現時與本集團任何五大客戶有任何關係。

於往績記錄期間，我們並無與客戶訂立長期或框架協議，而客戶的訂單由向我們發出的採購訂單確認。

業 務

定價政策及信用條款

我們的定價通常基於成本加成定價模式並進行調整，並參考以下因素確定：(i)產品的類型、複雜程度及設計；(ii)客戶指定的材料及規格；(iii)塑膠材料組合及其他原材料的成本；(iv)生產成本；(v)產品功能；(vi)同一採購的數量訂單，以及參考以下因素作出的調整；(vii)所涉客戶的細分市場；(viii)我們的市場推廣策略；及(ix)現行市場價格。我們的管理層會不時檢討我們的定價策略，以確保我們向客戶提供有競爭力的價格。

本集團進一步堅持內部折扣及回扣政策，以加強老客戶的忠誠度。內部折扣及回扣政策規範向客戶提供的折扣及回扣，並規定合資格客戶名單，該政策得到我們管理層的批准。嚴格遵循內部折扣及回扣政策，我們的銷售及市場推廣人員可向若干於批准名單上的客戶提供介乎1%至3%的預定折扣率或回扣率，並由管理層參考彼等的採購金額、我們的業務表現及市況視乎情況酌情決定。

於往績記錄期間，我們的所有銷售均以港元、人民幣或美元計值。向我們的客戶提供的一般付款條款的信貸期為自發票日期起計介乎0至90日。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們面臨貿易應收款項及票據減值。有關更多詳情，請參閱本文件內「財務資料－財務狀況表主要組成部分說明－貿易及其他應收款項、按金及預付款項」一節。

銷售及市場推廣

鑑於半導體行業的性質，聲譽及口碑推薦對我們至關重要，只有以長期往績記錄培養。由於我們的主要產品為訂造的托盤，作為後段半導體傳輸介質，應用於汽車、飛機及醫療設備等高科技產品的半導體器件，我們通過發展我們的技術知識，於客戶及我們集團之間獲得相互信任，與客戶建立默契及我們產品的可靠性，以滿足客戶的高標準和要求，努力管理我們的客戶關係。我們為每個客戶指定專門的銷售及市場推廣人員，以鼓勵更頻繁的溝通及更瞭解客戶的需求。我們經驗豐富的銷售及市場推廣人員亦擁有豐富的行業知識，便於就每個訂單中的產品規格進行討論。我們相信，客戶的推薦對我們多年來業務經營的持續擴展作出顯著貢獻。

業 務

除現有客戶的業務推薦外，我們亦嘗試通過各種方式接觸新客戶。我們經常參加世界各地的貿易展覽。於因COVID-19而無旅行限制的往績記錄期前，我們參加美國、法國及德國的貿易展覽。於往績記錄期間，我們參加於上海舉行的貿易展覽會Semicon China。我們認為參加展覽乃我們向全球潛在客戶介紹產品的好機會。我們亦將邀請客戶參觀我們於東莞的生產廠房，以瞭解我們的產品組合。我們的網站傳達有關我們產品類型及系列的詳細資料，進一步用作宣傳平台。

為維持與現有客戶的關係及開拓新商機，除銷售、市場推廣及客戶服務部門的員工支援香港、中國及新加坡的銷售辦事處外，我們亦委聘駐守我們銷售點的銷售代表與我們於相關地區的潛在及現有客戶聯絡，以於全球範圍內擴大覆蓋範圍及影響力。於往績記錄期間，我們分別聘請八名銷售代表。銷售代表主要負責與現有客戶保持密切的關係並提供即時技術支援，向本集團介紹新的客戶及商業機會，促進集團與客戶之間的溝通，跟進客戶產品的設計和規格。我們與銷售代表訂立的銷售佣金協議一般載有(其中包括)銷售代表的職責、每月固定費用金額及銷售佣金費率。我們支付予銷售代表的銷售佣金金額取決於商業談判，其費率取決於彼等的參與程度及其他因素，例如向客戶提供技術建議的可用性、新業務的規模和價值以及潛在的業務增長。

我們的董事確認，我們於往績記錄期間聘用的所有銷售代表均為獨立第三方，而支付予我們的銷售代表的佣金乃按公平磋商釐定。

產品缺陷及更換

我們通過對托盤及托盤相關產品的投訴進行初步評估以跟進對產品的任何投訴。對有關產品質量或缺陷問題的原因進行調查，以便有關部門實施適當的改進或整改措施。

我們不為我們的產品提供任何保修期。然而，對於客戶於使用時檢查貨物時發現的所謂產品質量或缺陷問題，我們提供產品更換。我們的質量保證部將檢查並安排對供應的相關批次產品進行測試，以分析問題及其原因。如產品問題並非我們造成，我們會向客戶解釋質量檢查及測試

業 務

結果，並相應進行關係管理程序。於我們對產品問題負責的情況下，我們將應用緩解程序(通常透過更換有缺陷的產品)以安撫客戶並製定改進計劃並實施預防措施，以盡量減少類似產品問題再次發生的風險。我們保持跨部門積極的內部溝通，以確保相應的計劃及措施得到充分執行。

於往績記錄期間，產品缺陷的性質一般為輕微缺陷。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，產品退貨及更換的金額分別約為0.3百萬港元、0.3百萬港元及0.1百萬港元，而截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，產品退貨及更換率分別為0.2%、0.1%及0.1%。於往績記錄期間，我們並無為我們的產品責任作出撥備。董事確認，於往績記錄期間，我們並無收到主要客戶就產品質量提出的任何重大投訴，亦無大規模召回我們的產品，亦無產生任何重大產品更換或相關費用。

採購及供應商

我們力求以嚴格的方式選擇供應商，以確保以合理的成本穩定供應優質的塑膠材料。我們已將之前通過並透過我們的資格評估獲准供應商名單列入候選名單。提供優質材料的能力、準時交貨乃我們評估供應商的關鍵因素。我們對獲批供應商名單進行年度審核，以確保其產品或服務質量、交付表現和供應價格持續符合我們的要求。於需要採購時，我們會比較入圍供應商的費用報價，必要時，我們會與各供應商進一步協商以獲得更有利的報價。

鑑於我們現有的主要供應商於質量、穩定供應及及時交貨方面的良好記錄，我們打算繼續向彼等採購。董事認為，與主要供應商發展長期密切的關係對我們的經營具有商業利益。我們認為，我們的成功很大程度上取決於我們通過提供廣泛的優質產品組合以定制客戶於生產中的需求能力。因此，以合理的價格穩定供應優質產品乃本集團選擇供應商以靈活適應生產的重點之一。

我們業務的重要塑膠材料包括原料塑膠材料、再生塑膠材料、再複合塑膠材料及定製塑膠材料。董事認為，由市場上有大量供應商，因此將能夠以合理的成本及時找到替代塑膠材料供應商。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到與供應商有關的營運出現任何重大產能不足、供應短缺、延誤或中斷，或供應商應佔任何重大產品索賠。

業 務

主要供應商

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二二年六月三十日止六個月，我們於各年度／期間的五大供應商分別佔採購總額約61.7%、55.2%及53.2%，而於各年度／期間，最大供應商則分別佔相關期間的採購總額約19.9%、15.9%及15.0%。我們的生產過程中使用多種材料、再生材料及再複合材料。原材料為直接用於生產或製造的原始材料。再生材料為無污染的熱塑性工程塑料，一般自表面貼裝技術行業的市場參與者採購。再複合材料為供應商根據本公司指示的方程式將再生材料結合原材料及添加物的加工材料。下表載列於往績記錄期間的五大供應商的概要資料：

排行	供應商	向我們提供的主要產品／服務	與本集團的業務關係年期	供應商業務活動	截至二零二零年十二月三十一日止年度			
					採購金額 (千港元) (概約)	佔我們採購總額的概約百分比	信貸期	付款方式
1	供應商A ⁽¹⁾	回收材料	12年	兩家分別於香港及中國註冊成立的公司，從事電子產品塑料製品的銷售、開發及製造	16,721	19.9%	月結單後 60至90日	透過電匯
2	供應商B ⁽²⁾	回收材料	5年	中國註冊成立的公司，主要從事銷售IC原輔材料及封裝材料、開發電子產品的技術專業知識、檢查、維護及銷售電子產品以及回收廢棄材料	13,992	16.6%	60至90日	透過電匯
3	供應商C ⁽³⁾	原材料及再複合材料	4年	於中國註冊成立的公司，從事工程及科技研發、新材料技術開發、技術諮詢服務以及電子產品及複合材料銷售	13,878	16.5%	月結單後 45日	透過電匯
4	供應商D ⁽⁴⁾	原材料	12年	中國公司(連同其附屬公司)，從事生產日常用途、醫療用途及工作安全設備等的塑膠產品	4,000	4.8%	月結單後 60日	透過電匯
5	供應商E ⁽⁵⁾	貨運服務代理	13年	中國公司，主要為航運物流代理	3,296	3.9%	月結單後 30日	透過電匯

業 務

截至二零二一年十二月三十一日止年度

排行	供應商	向我們提供的主要產品/服務	與本集團的業務關係年期	供應商業務活動	採購金額 (千港元) (概約)	估我們採購總額的概約		
						百分比	信貸期	付款方法
1	供應商D ⁽⁴⁾	原材料	12年	中國公司(連同其附屬公司)，從事生產日常用途、醫療用途及工作安全設備等的塑膠產品	17,476	15.9%	月結單後 60日	透過電匯
2	供應商A ⁽¹⁾	回收材料	12年	兩家分別於香港及中國註冊成立的公司，從事電子產品塑料製品的銷售、開發及製造	15,298	13.9%	月結單後 60至90日	透過電匯
3	供應商C ⁽³⁾	原材料及再複合材料	4年	於中國註冊成立的公司，從事工程及科技研發、新材料技術開發、技術諮詢服務以及電子產品及複合材料銷售	10,821	9.8%	月結單後 45日	透過電匯
4	供應商B ⁽²⁾	回收材料	5年	中國註冊成立的公司，主要從事銷售IC原輔材料及封裝材料、開發電子產品的技術專業知識、檢查、維護及銷售電子產品以及回收廢棄材料	10,347	9.4%	60至90日	透過電匯
5	供應商F ⁽⁶⁾	回收材料	5年	中國公司，主要從事生產及銷售塑膠產品	6,779	6.2%	90-120日	透過電匯

業 務

截至二零二二年六月三十日止六個月

排行	供應商	向我們 提供的主要 產品/服務	與本集團 的業務關 係年期	供應商業務活動	採購金額 (千港元) (概約)	估我們 採購總額 的概約		付款方法
						百分比	信貸期	
1	供應商F ⁽⁶⁾	回收材料	5年	中國公司，主要從事生產及銷售塑膠產品	9,403	15.0%	月結單後 120日	透過電匯
2	供應商D ⁽⁴⁾	原材料	12年	中國公司，從事生產日常用途、醫療用途及工作安全設備等的塑膠產品。	7,747	12.4%	月結單後 60日	透過電匯
3	供應商G ⁽⁷⁾	工具及模具 供應商	4年	於中國註冊成立的公司，從事模具及工具配件製造。	7,145	11.4%	模具合格 後90日	透過電匯
4	供應商A ⁽¹⁾	回收原材料	12年	於中國註冊成立的公司，從事電子產品塑料製品的開發及製造。	4,917	7.9%	月結單後 60至90日	透過電匯
5	供應商C ⁽³⁾	原材料及再複合 材料	4年	於中國註冊成立的公司，從事工程及科技研發、新材料技術開發、技術諮詢服務以及電子產品及複合材料銷售。	4,335	6.9%	月結單後 45日	透過電匯

附註：

- (1) 供應商A為兩間私人公司的集團。其中一間於二零零九年一月在中國成立，由兩名個人控制，註冊資本為約人民幣10百萬港元，另一間於二零二一年三月在香港註冊成立，由一名個人控制，股本為800,000港元。
- (2) 供應商B為一間私人公司，於二零一三年七月在中國成立，由兩名個人控制，註冊資本為約人民幣1百萬元。
- (3) 供應商C為一間私人公司，於二零一八年十二月在中國成立，由一名個人控制，註冊資本為約人民幣10百萬元。
- (4) 供應商D為一間於上海證券交易所上市的上市公司。其於一九九三年五月成立，於二零二一年十二月三十一日的註冊資本為約人民幣25.7億元。截至二零二一年十二月三十一日止年度，其收益為約人民幣402億元，權益應佔純利為約人民幣16.6億元。其亦全資擁有一間於香港註冊成立的私人公司，該公司於二零零九年七月成立。
- (5) 供應商E為一間私人公司，於二零零七年七月在中國成立，由一名個人控制，註冊資本為約人民幣2百萬元。

業 務

- (6) 供應商F為一間私人公司，於二零零六年六月在中國成立，由一名個人控制，註冊資本為約人民幣300,000元。
- (7) 供應商G為一間私人公司，於二零一八年八月在中國成立，由一名個人控制，註冊資本為約人民幣1,000,000元。

據董事所深知，於往績記錄期間，五大供應商全部均為獨立第三方，且概無擁有本公司已發行股本超過5%的董事或彼等之聯繫人或任何股東於本集團任何五大供應商中擁有任何權益於過往或現時與本集團任何五大供應商有任何關係。

塑膠材料

我們主要向第三方供應商採購原材料，例如PPO及ABS、回收材料、再複合材料及配方材料。就各類塑膠材料而言，我們一般有超過兩間供應商。我們相信，此做法可盡量降低違約及過份依賴任何特定供應商的風險。我們一般根據尚未完成銷售訂單及銷售預測的數量進行採購。我們的採購團隊一般僅會在向工程總監、行政總監及營運團隊副總裁尋求內部批准後，方會發出採購要求及採購訂單。我們亦將使用由我們未出售托盤及托盤相關產品中回收的塑料材料。

業 務

原材料的採購價格一般參考現行市況釐定。我們不會對原材料價格進行對沖活動。於往績記錄期間，我們並無因原材料價格波動而經歷業務或財務表現的任何重大不利影響。

模具

我們主要向中國第三方供應商採購模具。我們的模具主要用於模製托盤及托盤相關產品。設計及開發產品時，我們採納模塊化工具，可降低模具維修及維護的時間及成本。透過使用模塊化工具，倘工具出現故障，則僅須維護必要模塊。我們可使用形狀及尺寸相同的後備模塊(如有)作為臨時替代品，同時生產部門會維修有關模塊或倘無法維修，則我們可委聘供應商為我們生產新的模塊，此舉可降低模具維修及維護的時間及成本。

我們有多個來源可採購及訂造不同工具。我們相信，此做法可盡量降低違約及過份依賴任何特定供應商的風險。我們已與工具供應商建立長期關係，且我們一般於客戶與我們確認訂單後向供應商尋求報價。其後，在向行政及營運支援部的採購團隊主管尋求內部批准及客戶批准研發及材料工程部門準備的產品設計後，我們的行政及營運支援部會向供應商發出採購要求及採購訂單。我們一般根據客戶訂單採購模具。就不屬我們現有產品組合的產品訂單而言，我們會向供應商採購新模具，而就屬現有產品組合的產品訂單而言，我們會採購額外的有關型號模具作後備用途。於往績記錄期間，我們並無因模具價格波動而經歷業務或財務表現的任何重大不利影響。

存貨控制

我們一般根據生產時間表及銷售預測按需要向供應商下達訂單。我們一般維持足以應付兩個月正常生產運作的原材料存貨水平。

於二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一日及二零二二年六月三十日，我們分別錄得38.5百萬港元、60.1百萬港元及61.8百萬港元的存貨。我們的存貨週轉日數由二零二零財年的114日增加至二零二一財年的155日，並於截至二零二二年六月三十日止六個月增加至156日。我們認為，存貨水平大致穩定。

業 務

一般而言，我們會不時使用所收集的營運數據對銷售表現及存貨水平進行分析，從而運用有關數據優化各產品的存貨水平，並透過調整銷售及市場推廣活動盡量減少存貨老化。我們會定期進行盤點，以核實存貨水平記錄。我們會跟進每次盤點發現的任何存貨差異，並向管理部門報告。於往績記錄期間，我們亦並無經歷對業務營運產生任何重大不利影響的任何產品供應中斷或未能取得足夠數量的不可替代產品。

我們已制定全面系統監察存貨水平，包括於生產廠房的原材料及倉庫的產品。

我們會紀錄各生產廠房及倉庫存貨中的原材料存貨水平。我們亦會就生產記錄及追蹤原材料進出水平，讓我們的行政及營運支援部能夠決定採購相關原材料的適當時間。根據各類原材料的預定最高及最低水平以及存貨水平記錄，我們的採購團隊會得悉存貨水平跌至低於最低水平或超出最高水平，並相應作出採購調整。

同時為客戶及供應商的實體

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，就董事所深知及確信，其中一名五大客戶(即客戶B)亦為我們的供應商。客戶B為一間於美國註冊成立的公司(連同其附屬公司)，主要從事生產、設計及銷售電腦記憶體及電腦數據儲存。客戶B為我們的主要客戶之一，我們一直向客戶B供應應用於運輸及交付客戶B產品的托盤及托盤相關產品。客戶B一般會按折讓價格向我們重新出售已使用的托盤，有關安排乃就客戶B公司政策項下的廢料回收目的作出。我們會於生產托盤及托盤相關產品的過程中透過打碎托盤重新組合的方式使用已使用托盤。

業 務

下表載列往績記錄期間客戶B應佔的收益及採購的百分比：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零二一年	二零二一年	二零二二年
	%	%	%	%
			(未經審核)	
向客戶B銷售				
佔相關年度收益總額的百分比	12.7	10.2	10.8	11.0
平均毛利率	43.0	43.0	44.8	37.8
向客戶B採購				
佔相關年度採購總額的百分比	0.5	0.3	0.2	0.3

於往績記錄期間，向客戶B提供產品產生的毛利率與我們於同一期間的整體毛利率相若。此外，客戶B授出的信貸期與我們正常業務營運的信貸期一致。據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，客戶B及其相關最終實益擁有人均為獨立第三方。

轉讓定價安排

本集團一般視乎與客戶的具體協定的性質及需要，透過優博實業向多間位於中國、香港及其他海外國家的獨立供應商採購原材料。其後，生產工作會於沙田生產廠房及厚街生產廠房進行。生產過程完成後，製成品會出售予優博企業或直接出售予獨立客戶。就向優博企業出售的製成品而言，其會進一步向世界各地的獨立客戶出售。就位於東南亞地區的部分客戶而言，UBoT Inc.(新加坡)會向優博企業提供市場推廣服務，以協助與客戶溝通及推廣產品。

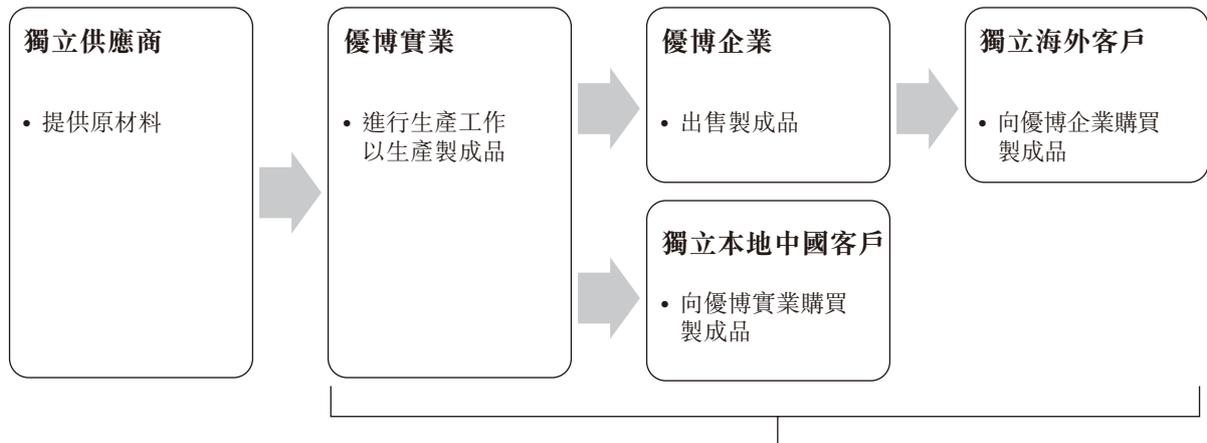
於各自的業務過程中，優博實業及優博企業履行不同職能。優博實業從事生產及銷售產品，於中國享有相對較低的生產成本。

業 務

另一方面，優博企業從事與位於不同國家及地區的客戶進行產品貿易。多年來，優博企業已建立為人熟悉的品牌名稱，因此，為發揮有關優勢，優博企業獲指定在位於海外的獨立銷售代表的協助及支援下，處理大部分向獨立客戶進行的對外銷售。因此作出優博實業向優博企業銷售製成品的安排，以利用各實體的相關優勢。有時，在優博實業直接自中國當地客戶收到採購訂單的情況下，由於銷售直接於中國進行，故優博實業會直接與該等中國客戶進行銷售交易，而不會向優博企業出售製成品，以供轉售予獨立客戶。

業 務

於往績記錄期間，屬本集團主要客戶的國家／地區包括中國、台灣、菲律賓、馬來西亞、美國、南韓、新加坡、泰國、歐洲、日本及印尼。下圖載列本集團若干製成品銷售的營運流程：



於整個銷售過程中，UBoT Inc. (新加坡) 履行營銷職能，協助與客戶溝通並推廣本集團的產品。

轉讓定價審閱

我們已委聘稅務顧問信永中和稅務及商業諮詢有限公司審閱往績記錄期間本集團旗下附屬公司之間的交易以及本集團的轉讓定價合規情況。

進行轉讓定價分析時，稅務顧問於進行轉讓定價審閱及基準分析（「轉讓定價分析」）時遵守香港、中國及新加坡的相關轉讓定價指引，轉讓定價分析採用交易淨利潤方法（TNM方法）作為轉讓定價方法，並採納(i)全成本加成比率（「FCMU比率」）及(ii)貝裡比率作為計量下文所示優博實業及UBoT Inc. (新加坡) 跨境關聯方交易溢利水平的相關指標。

根據本集團的現有業務模式，稅務顧問已識別出兩項主要跨境關聯方交易（「跨境交易」），並就此進行轉讓定價分析如下：

- i. 優博實業向優博企業銷售製成品；及
- ii. UBoT Inc. (新加坡) 向優博企業提供市場推廣服務。

業 務

存在轉讓定價風險的跨境交易概要如下：

集團公司名稱	交易性質	收取方集團 公司名稱	於二零二零 財年之金額	於二零二一 財年之金額
優博實業(中國)	銷售製成品	優博企業(香港)	約人民幣 57,338,834元	約人民幣 47,513,420元
UBoT Inc.(新加坡) (新加坡)	提供市場推廣服務	優博企業(香港)	約583,162 新加坡元	約554,967 新加坡元

就跨境交易的定價條款而言，本集團採納成本加成定價法為其產品定價。相關價格主要由湯先生(本集團控股股東及執行董事)以及本集團其他最高級管理層(包括陳先生及譚先生，彼等均為執行董事)參考以下各項釐定：

- i. 優博實業購買原材料的成本及其生產成本加加成；及
- ii. UBoT Inc.(新加坡)的市場推廣服務成本加加成。

轉讓定價風險著重審閱(i)優博實業向優博企業銷售製成品；及(ii)UBoT Inc.(新加坡)向優博企業提供市場推廣服務於往績記錄期間產生的溢利率是否與獨立第三方相若，並從而審閱是否按公平原則達致。

跨境交易的轉讓定價分析

鑑於生產相關的直接成本以及一般營運開支(例如間接員工、租金開支及其他一般行政開支)，TNM方法下的FCMU比例已獲採納為溢利水平指標，以於轉讓定價分析中評估優博實業(附註1)向優博企業銷售製成品的盈利能力。由於TNM方法下的貝裡比率僅用於測試並無擁有或使用任何無形資產的有限風險分銷商的溢利，故其已獲採納為評估UBoT Inc.(新加坡)(附註2)向優博企業(其透過提供市場推廣服務為交易增值)提供市場推廣服務的盈利能力的溢利水平指標。

我們的稅務顧問選定潛在可資比較公司，該等公司擁有與本集團產品類別(即從事為半導體行業生產塑膠托盤)相同或類似的標準行業分類(SIC)代碼。此外，由於本集團主要於香港、中國及新加坡營運，故類似地理位置(即遠東及中亞地區)的參考數字已用作進行可資比較研究。具體而言，我們的稅務顧問納入就收益而言擁有不同營運規模的潛在可資比較公司，原因為轉讓定價

業 務

分析主要著重FCMU／貝裡比率，其為比率分析，而非絕對值分析。我們的稅務顧問認為，選定的數據提供詳盡清單及全面反映行業營運情況，提高轉讓定價分析結果的可靠性，可獲得各地稅務機關更廣泛及全面的認可。

附註：

- (1) 優博實業於計量溢利水平時採納FCMU比率，原因為有關比率全面計及實體的整體溢利水平與所產生的整體開支的比較，就轉讓定價基準研究而言適合用於優博實業從事的生產及貿易業務。
- (2) UBoT Inc.(新加坡)於計量溢利水平時採納貝裡比率，原因為有關比率評估實體就其增值分銷活動賺取的回報(即毛利)，並假設該等活動的成本為實體的營運開支，就轉讓定價基準研究而言適合用於UBoT Inc.(新加坡)從事的提供市場推廣服務。

優博實業與優博企業之間的關聯方交易

根據稅務顧問的發現，尤其是對優博實業作為精密工程塑膠製造商所承擔職能及風險的分析，相關可資比較公司的數據乃摘錄自OSIRIS數據庫，以進行比較。根據數據選定程序及轉讓定價分析下進行的分析，優博實業就二零二零財年(1.03%)及二零二一財年(-4.65%)計算的FCMU比率屬可資比較公司於二零一八年至二零二零年的平均FCMU比率四分位數範圍(即-4.91%至5.65%，中位數為1.97%)。

基於上文所述，稅務顧問認為，往績記錄期間優博實業與優博企業之間的關聯方交易基於特定轉讓定價基準方法的應用，可視為按公平基準進行。本集團致力確保日後的跨境交易將按公平基準進行，並會採取多項措施確保符合營運所在司法權區的相關轉讓定價法律及法規。

UBoT Inc.(新加坡)與優博企業之間的關聯方交易

為促使優博企業與其東南亞(例如新加坡及馬來西亞)客戶的溝通，UBoT Inc.(新加坡)以提供與該等東南亞地區客戶直接聯絡服務的方式，向優博企業提供市場推廣服務。UBoT Inc.(新加坡)透過於新加坡設立辦事處及聘用當地員工進行有關活動。就上文所述而言，UBoT Inc.(新加坡)的市場推廣服務成本為其提供有關市場推廣服務產生的多項日常營運成本，包括員工成本、

業 務

交通成本及辦公用品。根據稅務顧問的發現，尤其是對UBoT Inc.(新加坡)作為精密工程塑膠市場推廣服務供應商所承擔職能及風險的分析，相關可資比較公司的數據乃摘錄自OSIRIS數據庫，以進行比較。根據數據選定程序及轉讓定價分析下進行的分析，UBoT Inc.(新加坡)就二零二零財年(0.96)及二零二一財年(1.02)計算的貝裡比率較可資比較公司於二零一八年至二零二零年的平均貝裡比率四分位數範圍(即1.26至1.83，中位數為1.53)為低。

在正式的官方轉讓定價調整做法(如有)中，就有關個案作出的調整應由UBoT Inc.(新加坡)的新加坡主管稅務機關就貝裡比率的趨勢預置。稅務顧問作出可獲新加坡主管稅務機關公認的假設性調整，即將UBoT Inc.(新加坡)於二零二零財年及二零二一財年的溢利水平分別調整為1.53的貝裡比率，即可資比較公司的貝裡比率中位數。

所涉及的納稅人(即UBoT Inc.(新加坡)及優博企業)應有權就稅務機關就UBoT Inc.(新加坡)的稅務狀況首先作出相應調整，其後由稅務局就優博企業的稅務狀況作出調整。對UBoT Inc.

業 務

(新加坡)作出的額外溢利調整會導致UBoT Inc.(新加坡)於二零二零財年及二零二一財年的應課稅溢利增加及按17%稅率計算的新加坡企業所得稅責任增加。另一方面，優博企業於二零二零財年及二零二一財年按16.5%利得稅稅率計稅的應課稅溢利將會減少。

在該等情景下，UBoT Inc.(新加坡)於二零二零財年及二零二一財年的溢利上調估計將分別為340,042新加坡元及272,117新加坡元，導致分別產生額外新加坡所得稅責任57,807新加坡元及46,259新加坡元(相當於約339,000港元及267,000港元)。

另一方面，優博企業的收入會減少340,042新加坡元及272,117新加坡元(相當於約1.99百萬港元及1.57百萬港元)，利得稅責任會相應減少約329,000港元及260,000港元。對本集團而言，整體稅務影響將為稅務責任分別淨增加10,000港元及7,900港元。就此而言，由於整體稅務責任調整金額極低，故稅務顧問預期即使在轉讓定價調整的情境下亦毋須作出重大所得稅撥備。誠如稅務顧問所建議，董事認為本集團的轉讓定價安排符合相關轉讓定價法律法規。

誠如董事所確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團的轉讓定價安排並無被香港、新加坡或中國任何相關稅務機關質疑或調查。本公司管理層已經及將會繼續密切監察本集團的轉讓定價安排，包括不時檢討集團內公司間交易的定價政策的合理程度。

關聯交易的商業理由

優博實業為於中國成立的公司，從事生產及銷售產品，而優博企業為於香港註冊成立的公司，從事與位於不同國家及地區的客戶進行產品貿易。為提升本集團管理及業務營運成效、提高採購靈活性、利用各實體的相關優勢及避免將銷售及採購／生產職能集中於本集團內的單一實體，本集團安排優博實業向優博企業銷售製成品，以轉售予獨立客戶。

知識產權

最後實際可行日期，本集團已於香港、中國及台灣註冊合共三個商標。此外，本集團已於中國、美國及香港註冊合共15個專利。

有關知識產權(董事認為對我們的業務及營運而言屬重大)的詳情載於本文件附錄四「B.有關本集團業務之更多資料－2.知識產權」一節。董事相信，本集團已申請註冊或已註冊所有對業務及營運屬必要及重大的知識產權。

業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及侵犯他人的知識產權或他人侵犯我們的知識產權，而會對我們的業務產生重大不利影響，我們並無涉及任何有關侵犯知識產權的法律訴訟。

獎項及認可

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們就業務獲頒發以下獎項及認可：

獲獎年份	實體	獎項／認可	頒獎機構
二零二零年一月二十七日	優博創新微機電	ISO9001:2015	英國標準協會
二零二二年一月十九日	優博實業	ISO9001:2015	Intertek Certification Limited
二零二二年一月十九日	優博實業	ISO 14001:2015	Intertek Certification Limited
二零二一年二月二日	優博實業	ISO 45001:2018	Intertek Certification Limited

競爭

根據F&S報告，全球後段半導體運輸媒介行業為集中的市場，少於30名市場參與者，且頂級市場參與者佔大部分市場佔有率。有關市場架構背後的原因主要為半導體器件價值高，令印刷電路板組裝廠的運輸媒介缺陷成本高，因此傾向於向聲譽良好的市場參與者採購，不會因定價更具競爭力的產品犧牲質素。後段半導體運輸媒介行業的主要競爭因素為就提供優質產品及良好聲譽與知名的半導體製造商建立長期關係的能力，以及迅速解決客戶需要的能力。我們在全球後段半導體運輸媒介行業中的托盤及托盤相關產品製造商中取得排行第三的公司的地位，佔7.6%的市場佔有率。

業 務

鑑於後段半導體運輸媒介行業持續擴充，我們相信，我們將能夠在此盈利市場中，憑藉我們的市場地位、穩健的行業聲譽、廣泛的產品組合、與知名公司的長期關係以及全球分銷及支援取得更高市場佔有率。

有關行業競爭環境給我們的競爭優勢的進一步資料，請參閱本文件「行業概覽」一節及本節「競爭優勢」一段。

員工

於最後實際可行日期，我們有約475名全職員工，當中28名、444名及三名分別位於香港辦事處、中國辦事處及生產廠房及新加坡辦事處。下表載列最後實際可行日期按職能劃分的全職員工人數：

	香港辦事處	中國辦事處及 生產廠房	新加坡辦事處
銷售、市場推廣及客戶服務	8	3	3
製造	3	310	—
研發及材料工程	2	26	—
質素保證	—	39	—
管理	4	—	—
財務	7	7	—
行政及營運支援	2	56	—
資訊科技支援	2	3	—
總計	<u>28</u>	<u>444</u>	<u>3</u>

薪酬

我們已與員工訂立書面僱傭合約。我們提供的薪酬待遇包括基本薪金、超時薪金及表現相關花紅（銷售員工為佣金率或生產員工為計件工資）。就中國員工而言，我們亦提供法定社會保險供款及（如適用）住宿及膳食。我們的薪酬待遇整體由表現主導，管理層會每年審閱及評估員工表現。董事相信，本集團的薪酬待遇在市場上具有競爭力。

業 務

培訓及招聘

我們已致力為員工提供全面培訓，以加強歸屬感及工作奉獻精神。新員工須參與我們的迎新活動，並會獲提供員工手冊，當中載有行為守則及保密義務。我們鼓勵現任員工參與本集團提供的定期培訓計劃。除內部培訓外，我們亦安排員工參與監管機構舉辦有關安全教育的外部培訓。

我們一般透過於招聘網站發佈網上廣告或招聘活動招聘員工。就管理層職位而言，我們亦會委聘職業介紹所進行招聘。

員工福利及關係

於香港，我們為員工參與強制性公積金計劃條例(香港法例第485章)訂明的強制性公積金計劃。

於中國，我們參與中華人民共和國社會保險法訂明的基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。於往績記錄期間，本集團有關於社會保險及住房公積金供款的不合規事件。有關詳情，請參閱本節「法律合規、牌照及許可－法律合規」一段。除本段及上述段落披露者外，董事根據中國法律顧問的意見，已確認於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團已於所有重大方面遵守中國相關勞動及社會保險法律法規，經相關政府主管部門確認，並無任何中國政府機關就任何勞動及社會保險事宜對本集團施加罰款。

在中國附屬公司當中，優博實業及優博創新微機電已根據相關中國法律法規成立工會，以保障員工的勞動權利及權益。優博實業及優博創新微機電目前的工會法人資格證書有效期分別直至二零二七年三月及二零二四年九月。

於往績記錄期間，我們並無經歷任何重大勞資糾紛導致的營運中斷，亦無員工提出對業務產生重大不利影響的投訴或索償。董事相信，我們已與員工建立良好關係。

業 務

物業

於最後實際可行日期，我們於新加坡有一項租賃物業、於香港有一項租賃物業及於中國有八項租賃物業。

新加坡租賃物業

於最後實際可行日期，我們於新加坡租賃以下物業：

地點	物業用途	租期	租金	概約總建築面積 (平方米)
Ruby Industrial Complex, 80 Genting Lane, #04-01F Singapore 349565	銷售辦事處及電話中心	一年，直至二零二二年十月三十一日	每月租金為560.14新加坡元，並就開出12張支付租金的遠期支票每月收取133.00新加坡元之折扣	16

香港租賃物業

於最後實際可行日期，我們於香港租賃以下物業：

地點	物業用途	租期	租金	概約總建築面積 (平方米)
新界荃灣海盛路9號有線電視大樓35樓8室	總部及香港主要營業地點	兩年，直至二零二四年六月三十日	每月租金為38,000.00港元	256

業 務

中國租賃物業

於最後實際可行日期，我們於中國租賃以下物業：

編號	地點	物業用途	租期	租金	概約總建築面積 (平方米)
1.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 成田路17號 1號樓(「物業A」)	生產廠房及 宿舍	三年，直至 二零二四年 十二月三十一日	每月租金為 人民幣123,681元	8,407
2.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 成田路17號 3號樓(「物業B」)	生產廠房	三年，直至 二零二四年十二 月三十一日	每月租金為 人民幣16,870元	847
3.	中國 廣東省 東莞沙田鎮 信鴻灣區 智谷1號 1204及1205室	倉庫	五年，直至 二零二七年七月 十二日	每月租金為 人民幣66,402 元，每36個月的 租金增幅為10%	3,905.97
4.	中國 廣東省 東莞市厚街鎮 環岡村 白山頭地段 B棟及C棟	生產廠房及 倉庫	十年，直至 二零二八年一月 二日	每月租金為 人民幣264,117 元，每36個月的 租金增幅為10%	12,973
5.	中國 廣東省 東莞沙田鎮 紫薇銀座 2棟2302室	住宅－員工 宿舍	一年，直至 二零二二年十月 三十一日	每月租金為 人民幣2,500元	95.04

業 務

編號	地點	物業用途	租期	租金	概約總建築 面積 (平方米)
6.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 東港城花園 8座 4層01單位	住宅－員工 宿舍	一年，直至 二零二三年七月 二十日	每月租金為 人民幣2,100元	113
7.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 東港城花園 3B301房	住宅－員工 宿舍	一年，直至 二零二三年六月 三十日	每月租金為 人民幣1,836元	108
8.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 東港城花園 一期1棟 E座901單位	住宅－員工 宿舍	一年，直至 二零二三年二月 二十八日	每月租金為人民幣 2,250元	125
9.	中國 廣東省 東莞市沙田鎮 東港城花園 二期12棟 601單位	住宅－員工 宿舍	兩年，直至 二零二三年十二 月三十一日	每月租金為 人民幣2,100元	113

物業A及物業B乃租自我們的控股股東鄧氏家族間接非全資擁有的公司成田置業。除物業A及物業B外，所有餘下物業均向獨立第三方租賃。有關向成田置業租賃物業的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」一節。

業 務

於最後實際可行日期，我們並無賬面值佔我們總資產15%或以上的單一物業，因此，根據GEM上市規則第5.01A條，我們毋須於本文件內加入任何估值報告。根據《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第6(2)條，本文件獲豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例第342(1)(b)條關於公司(清盤及雜項條文)條例附表三第34(2)段的規定，該段要求對所有土地或建築物的權益作出估值報告。

與許可用途不一致

我們目前使用物業B作為我們生產MEMS及傳感器封裝解決方案的生產基地，而建築物所有權證書所允許的用途為食堂。經我們的中國法律顧問告知，物業B所建土地的土地使用權為工業用途，且將物業B用作生產場地不違反規定的土地使用權，但與建築許可證用途不符，其說明須用作「食堂」。誠如我們的中國法律顧問所告知，鑑於上述不一致情況，本集團已委任建築代理編製必要文件，以向地方自然資源局提交更改物業B許可用途為「工廠」用途的申請。於最後實際可行日期，本集團正在編製一套完整的經修訂施工圖，以符合將向有關當局提交的實際物業用途狀況。地方自然資源局的申請過程及審批過程預期將於二零二二年年底前完成，否則存在本公司可能無法繼續使用B物業作為生產場地的風險。於最後實際可行日期，我們並無收到對我們佔用及使用物業B的權利的質疑。中國法律顧問認為，無法使用該物業的可能性較小：(i)目前用途與土地使用權證許可用途一致；(ii)東莞市住房和城鄉建設局已發出證書，確認優博創新微機電就物業B作為工業車間的消防驗收備案提交申請文件已完成及獲批准備案；(iii)並無對優博創新微機電提起或施加行政訴訟；(iv)優博創新微機電已與B物業的業主聯絡，以申請更改B物業的使用許可。董事認為，如實際土地用途與允許的土地用途不一致導致我們無法繼續租賃，因此需要將我們MEMS及傳感器封裝解決方案的生產設施搬遷至其他地方，我們可在物業A及厚街生產廠房重新安排生產空間，故物業A的部分成型機將搬遷至厚街生產廠房，以於物業A騰出更多空間容納優博創新微機電生產設施。上述安排將不會對我們的業務及財務狀況以及擴充計劃產生任何重大不利影響。

業 務

未有登記租賃物業

根據適用的中國法律及法規，物業租賃合約須向相關中國政府機構登記。於最後實際可行日期，我們已就上述第1至4項租賃物業提交四份租賃合約以進行登記，有待相關地方當局回覆，有關登記尚未完成。據中國法律顧問所告知，根據中國法律，缺乏登記的租賃合約不會影響租賃合約的有效性，本集團有權佔用及使用所有租賃物業。中國法律顧問進一步告知我們，相關場所所在的中國政府直轄市、市及縣的建設(房地產)主管部門要求的規定時限內登記租賃，否則可能對未登記的各項租賃處以最高人民幣10,000元的罰款。未能完成我們所租賃物業的租賃登記的估計最高罰款將為人民幣40,000元。我們的董事認為，且我們的中國法律顧問同意，罰款將不會對本集團的業務及財務狀況造成任何重大不利影響。

有關向鄧先生租賃上述物業的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」一節。

業 務

保險

本集團投購各種保險，以涵蓋業務營運，我們會不時評估保單是否充足。本集團投購的保單包括公共責任、員工補償、業務中斷、關鍵人員及財產一切險等。此外，根據相關中國法律法規，我們須為僱員的社會保障保險及住房公積金作出供款。有關進一步詳情，請參閱本節「員工」一段。

我們已就二零二一年三月十九日發生的沙田倉庫火災對財產一切險保單作出6.1百萬港元的保險索償，優博實業與保險公司之間已於二零二一年十二月二十九日結清有關索償。除上文披露者外，我們並無提出或受任何重大保險索償所限。

鑑於上文所述，董事認為保險涵蓋範圍屬充足，並符合行業標準。

健康及職業安全

我們已就員工的健康及職業安全訂立一系列內部政策及手冊。我們的生產廠房有安全主任駐守。我們已制定安全指引已盡量降低生產過程中工作相關意外及受傷的風險。詳細指引(包括適當保護工作裝備、使用設備及機器前進行的檢查、設備及機器操作手冊以及報告及處理工作相關意外及受傷的程序)納入內部安全政策及手冊。此外，我們工作安全為員工提供定期培訓計劃，作為加強工作場所安全的持續措施。

我們已引入報告及處理意外的標準程序。於意外發生後，員工會向相關生產團隊組長報告，有關主管會通知主管及部門經理處理個案。生產團隊組長須根據標準範本提供意外詳情，以供人力資源經理審閱及批准。人力資源經理負責評估意外的影響，並批准後續病假及賠償。

業 務

下表載列於往績記錄期間本集團已呈報的工作相關意外及意外率：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零二一年	二零二一年	二零二二年
已呈報的工作相關意外數目	2	3	無	無
本集團的意外率 ^(附註)	0.5%	0.7%	無	無

附註：本集團的意外率按所呈報意外數目除以相關期間結束時之生產員工總數計算。

COVID-19疫情爆發對我們業務的影響

COVID-19疫情已經在全球蔓延。COVID-19具有高度傳染性，並在中國及其他國家導致死亡。於二零二零年一月三十日，世界衛生組織宣佈COVID-19爆發為國際關注的突發公共衛生事件，其後於二零二零年三月十一日將COVID-19定性為大流行病。中國當局已採取各種措施，例如對居民及旅客進行強制隔離、封鎖部分城市以及在中國春節假期後將業務單位的運營推遲至二零二零年二月中旬。自二零二一年七月以來，出現了COVID-19的變種病毒，如Delta及Omicron（「復發」）。

由於東莞地方政府實施限制，我們的沙田生產廠房於二零二零年二月初暫停營運逾一週。由於Omicron於二零二二年三月在東莞爆發，東莞受COVID-19影響的地區的生產活動被限制約一週。根據董事目前可得的資料，並考慮到政府為控制COVID-19蔓延而採取的措施，董事認為，COVID-19不會對本集團產生永久性影響或對我們的業務運營造成重大干擾。

董事相信，復發並無對本集團的業務營運及財務表現造成任何重大影響，主要原因為：(i)復發遠較二零二零年初COVID-19爆發的疑似或確診病例數目不嚴重；(ii)復發已因相關當局的快速反應而受到有效控制；及(iii)政府當局、客戶及供應商以及本公司已根據過往經驗制定相應制度應對COVID-19，以減輕其潛在影響。儘管我們的業務營運於二零二零年二月初及二零

業 務

二二年三月暫時受到COVID-19所影響，但與二零二零年同期比較，本集團仍能夠於截至二零二一年十二月三十一日止年度達致整體收益增長及毛利率增加。基於上文所述，執行董事認為，COVID-19爆發並無對我們的業務、財務狀況、營運業績及增長前景造成重大不利影響。

董事密切關注COVID-19爆發的發展。根據《中華人民共和國傳染病防治法》及《突發公共衛生事件應急條例》，本集團已制定《應對COVID-19爆發的應急措施》以保護我們員工的健康並降低感染冠狀病毒的風險。日常預防措施包括：

- (i) 所有員工於進入本集團場所前均須進行每日體溫檢查。
- (ii) 所有員工必須於本集團場所內佩戴醫用口罩。
- (iii) 倘任何員工於過去14天內出現上呼吸道感染症狀／從受COVID-19嚴重影響的地區返回／與COVID-19患者有密切接觸，其應於上班前進行14天居家隔離。

沙田倉庫火災的影響

於二零二一年三月，我們的沙田倉庫因發生短路而引起火災，但並無人員傷亡。鑑於該火災，本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得存貨虧損約7.7百萬港元。我們的沙田倉庫亦自火災起暫停運作。東莞市消防救援支隊沙田大隊已發出火災事故認定書，當中釐定火災並非因本集團的任何疏忽造成。沙田倉庫已於火災後停止運作。我們已租用另一個設有更先進消防安全設施的場地代替沙田倉庫。

儘管因火災而暫停營運，惟本集團的業務營運及財務表現並無受火災影響，原因為(i)並無發生延遲交付產品的情況，原因為本集團以其他倉庫的現有存貨履行客戶的採購訂單；(ii)厚街生產廠房於二零二一年投產，且其他倉庫可代替沙田倉庫提供存貨儲存空間；(iii)截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團因火災而自保險公司收到賠償約6.1百萬港元。

於火災後，本集團已採納經改進的內部控制措施，以避免類似事件再次發生，包括改善防

業 務

火設施，例如在生產廠房的工作站安裝灑水系統、實施緊急準備及應對管理程序，並制定緊急應該演習計劃。

環境、社會及企業管治

管治

我們瞭解我們在環保及社會責任方面的責任，並意識到與氣候有關的問題可能對業務營運造成影響。我們承諾於[編纂]後遵守環境、社會及管治(「ESG」)報告規定。我們已按照GEM上市規則附錄20的標準制定ESG政策(「ESG政策」)，該政策概述(其中包括)(i)ESG事項的適當風險管治，包括與氣候有關的風險；(ii)識別主要利益相關者及與彼等溝通的渠道；(iii)ESG管治架構；(iv)ESG策略制定程序；(v)ESG風險管理及監測；及(vi)識別關鍵績效指標(「關鍵績效指標」)、相關測量及緩解措施。

我們的ESG政策亦載有各方在管理ESG事宜過程中各自的責任及權力。董事會整體負責監督及確定影響本集團的環境、社會及氣候相關的風險及機會，制定及採納本集團的ESG政策及目標，根據ESG相關目標每年檢討本集團的表現並調查變動的原因，適當修改ESG策略以適應本集團的未來發展及業務策略。

業 務

董事會已成立ESG工作小組，由總經理及多個部門主管組成，包括但不限於財務部、研發部以及材料工程部、生產部以及行政及營運支援部。ESG工作小組支援董事會實施協定ESG政策、目標及策略；參與年度企業風險評估；進行ESG範疇的重大評估以及評估本集團業務如何適應氣候變化；於編製ESG報告時向不同人士收集ESG數據；及持續監察處理本集團ESG相關風險的措施的實施情況。ESG工作小組亦負責調查目標的偏離情況，並與相關職能部門聯絡，以就有關偏離情況採取及時的糾正行動。ESG工作小組須每季度透過董事會會議向董事會報告本集團的ESG表現及ESG制度的成效。

應對ESG相關風險的策略

本集團將至少每年進行一次企業風險評估，涵蓋本集團面臨的現有及潛在風險，包括但不限於ESG方面的風險及來自圍繞氣候變化等顛覆性力量的策略風險。董事會將評估風險並審查本集團的現有策略、目標及內部控制，並將實施必要的改善措施以緩解風險。董事會、審核委員會及ESG工作小組將繼續監督本集團的風險(包括氣候相關風險)管理方法，並作為標準營運流程的一部分，對風險進行監控，以確保在定期管理審查中採取適當的緩解措施。緩解、轉移、接受或避免風險的決定為在我們的企業風險評估過程後所得出，並直接影響該等已識別風險的緩解步驟。本集團將氣候相關問題(包括實體及轉型風險分析)納入風險評估流程及風險偏好設置。倘風險及機遇被視為重大，本集團將在策略及財務規劃過程中予以參考。對ESG相關風險以及本集團應對風險的績效進行年度審查後，我們或會適當修訂並調整ESG策略。

就ESG報告而言，董事會亦已透過不同溝通渠道進行持份者參與，以及ESG範疇的重要性評估，以根據GEM上市規則附錄二十的標準識別出對本集團及持份者而言屬關鍵的ESG範疇。進行重要性評估時，本集團意識別出若干關鍵的ESG範疇，包括環境及資源管理、產品質素及產品退貨、職業健康及工作安全、知識產權保護及客戶資料私隱管理。我們已制定一套ESG政策，以降低該等範疇的風險，確保我們遵守地方法律及規例。該等關鍵ESG範疇可能會為本集團帶來各種風險及機會。本集團將繼續監察相關表現。

業 務

影響及應對ESG相關風險的緩解措施

環境及資源管理

我們的業務營運須遵守中國政府頒布的相關環境保護法律法規，其概要載於本文件「監管概覽－中國法律及法規－有關環境保護有關的中國法律及法規」一節。我們已實施內部環境保護措施，並已通過ISO14001：2015環境管理體系標準認證。此外，建設任何新的生產設施或對任何現有生產項目的裝修或擴建必須遵守環境影響評估法規。就需進行環境影響評估的各項生產項目而言，我們會提交環境影響評估文件供相關中國法律法規規定的相關環境當局審批。

業 務

廢物管理

於產品的生產過程中，我們會產生噪音、廢氣、廢水及固體廢物污染物。以下載述對主要環境相關風險的主要管治措施。

- 固體廢物

我們將固體廢物分為三類：

- 可回收無害固體廢物，如封裝材料；
- 不可回收危險固體廢物，如廢活性炭及廢機油；及
- 不可回收無害固體廢物。

我們已委聘合資格第三方服務供應商收集、處理及回收廢棄材料，尤其為有害固體廢物。日常營運產生的日常生活廢物根據地方垃圾分類規定儲存，其後由地方環境及衛生部門轉送廢物處理廠。

- 廢水

我們生產過程中的工業廢水並不重大。然而，工業廢水(如有)須由合資格第三方服務供應商回收。生活廢水由我們的污水淨化設備處理，確保廢水經合法處理後才排放。

- 廢氣

我們生產過程中產生的廢氣主要由紫外光解裝置、活性炭吸附設備及生物滴濾器收集及處理後，才排放至更高的大氣中。

業 務

- 噪音控制

生產設備運作過程中可能會產生噪音。我們透過在工廠大廈建設隔音牆、安裝隔音窗戶及大門，以盡量降低噪音排放。本集團採納隔音及減震措施，以降低機器及設備產生的噪音水平。

董事確認，我們已根據對我們的營運而言屬重大的中國環境法律法規取得適用的許可及牌照。更多詳情請參閱「業務－法律合規、牌照及許可－牌照及許可」。我們的中國法律顧問確認，我們於所有重大方面遵守中國適用環境法律法規。於往績記錄期間，相關主管政府部門確認，我們並無因重大違反中國任何環境法律法規而受到行政處分、懲罰或處罰，且據董事經作出一切合理查詢後所知，並無任何中國環境政府機構就此採取有威脅或未決的行動。於二零二零財年、二零二一財年及二零二二年六個月，我們遵守適用環保規則及法規的年度成本分別為約人民幣0.1百萬元、人民幣0.7百萬元及人民幣0.2百萬元。我們主要透過購買及安裝環保設備及設施以及監管環境影響及回收有害固體廢物產生該等開支。本集團於二零二二財年隨後月份的環境合規及相關風險緩解預算為約人民幣1.1百萬元，為達成本集團未來環境相關事項目標的開支。

資源管理

作為負責任的企業公民，我們致力於提升可持續發展能力以及旨在杜絕資源浪費，以免對環境造成損害。

在我們的營運中，塑膠材料是我們生產過程中所使用的最重要的原材料，主要包括塑膠原料、回收塑膠材料、再複合塑膠材料及定製塑膠材料。在採購階段，具有環保相關認證及資格的潛在塑膠材料供應商會獲優先考慮。我們亦會應用回收自未出售的托盤及托盤相關產品製成品的塑膠材料。在生產階段，我們的研發及材料工程部擁有1)設計及開發複雜材料配方以及2)對該等配方進行成本分析，以實現成本效益及監控浪費情況。儘管塑膠材料成本為我們銷售成本的主要組成部分，會直接隨收入變化，但我們相信，上述措施可實現旨在超逾「減少消耗」層面的塑膠材料之有效消耗，並且我們致力於將資源盡可能用得其所。展望未來，我們擬以可持續發展的方式擴充，並盡最大努力將截至二零二三年十二月三十一日止年度的塑膠材料使用水平控制於二零二二財年的115%內。

業 務

下表載列往績記錄期間塑膠材料消耗的定量披露。

	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度	截至二零二二年 六月三十日 止六個月
塑膠材料(噸)	5,760.15	6,448.66	3,120.18
密度(噸/千港元收益)	0.03	0.03	0.03

我們的能源消耗主要源自生產過程中使用機器及設備的電力消耗。電力價格波動可能影響業務成本。於二零二一年最後一季，廣東省若干地區電力供應短缺，沙田生產廠房及厚街生產廠房因電力短缺而使用發電機，導致有關期間電力成本較高。電力成本增加透過按成本加成基準釐定產品售價的方式由本集團及客戶分擔，當中參考電力成本、溢利率等，其將繼續為我們日後管理任何電力成本增加的主要方法。我們的電力消耗亦為溫室氣體排放的主要來源。我們已實施於營運過程中提升能源效益的措施，以履行我們的環境及社會責任，並減少電力成本。例如，規定員工在並無使用裝置時及離開物業前關掉燈光、機器、設備及其他電子裝置；使用更具能源效益的照明產品，例如LED燈及自動控制溫度的空調系統。

ESG相關風險的指標及目標

溫室氣體(「溫室氣體」)排放與氣候變化息息相關，這為企業帶來長期風險及機遇。為更好地瞭解、量化及管理於我們的營運中與影響、風險及機遇有關的碳及氣候變化，作為ESG旅程中的第一步，計量及披露碳足跡是不可或缺的。

鑑於我們的能源消耗主要來自生產過程中使用機械及設備的電力消耗，溫室氣體排放主要包括範圍2間接排放。由於本集團並無自有車輛，因此空氣污染物的排放量並不顯著，相反，二零二一年期間在中國租用一輛貨車僅為在當地進行有限度交付之用。

下表載列往績記錄期間我們於中國營運所產生的溫室氣體排放、能源消耗及廢物的量化披露。

業 務

	截至 二零二零年 十二月 三十一日 止年度	截至 二零二一年 十二月 三十一日 止年度	截至 二零二二年 六月三十日 止六個月
溫室氣體排放			
範圍1直接排放(噸二氧化碳當量)	11.66	278.27	22.49
範圍2間接排放(噸二氧化碳當量)	4,812.38	5,430.84	2,504.65
總量(噸二氧化碳當量)	4,824.04	5,709.11	2,527.14
密度(噸二氧化碳當量/千港元收益)	0.03	0.03	0.02
能源消耗			
柴油(千瓦時)	47,757.87	1,139,403.08	92,092.63
外購電力(千瓦時)	7,887,862.00	8,901,557.00	4,105,303.00
總量(千瓦時)	7,935,619.87	10,040,960.08	4,197,395.63
密度(千瓦時/千港元收益)	47.81	49.48	34.83
有害廢棄物(公斤)	2,880.00	2,630.00	8,853.00
無害廢棄物(公斤)	579,149.00	657,289.00	400,990.00
總量(公斤)	582,029.00	659,919.00	409,843.00
密度(公斤/千港元收益)	3.51	3.25	3.40

本集團的排放目標包括(i)廢棄物處理、排水、廢氣排放及噪音釋放的100%達標率以及(ii)零投訴。展望未來，我們計劃控制能源消耗及溫室氣體排放，目標為於截至二零二三年十二月三十一日止年度維持相關水平於二零二二財年的90%至110%。此外，我們亦計劃於截至二零二三年十二月三十一日止年度較二零二二財年減少產生5%廢棄物。本集團將繼續定期監察廢水、固體廢物的排放、噪音控制及空氣污染控制，而我們的人力資源部將繼續記錄污染物排放情況。

應對氣候變化

就可能影響我們的重大氣候變化相關影響而言，我們參考氣候相關財務披露工作小組(「財務披露工作小組」)框架評估氣候影響的程度。

業 務

潛在氣候變化風險可分類為(a)過渡風險：即遵守適用環境法律法規及嚴格環保標準產生的風險；及(b)物理風險：即急性天氣相關事件及氣候模式的長期慢性變化所造成的損害之風險。

以下為本集團識別的短期、中期及長期氣候相關風險摘要。

	風險	來源	潛在影響
短期	物理風險	— 極端天氣情況，例如洪水及暴風雨	— 因資產損毀及供應鏈中斷而導致收益減少 — 營運開支增加
長期	過渡風險	— 氣候相關規例變化 — 客戶喜好轉變	— 規例變化導致已售存貨成本增加 — 對我們的產品需求下降

為應對過渡風險，尤其是(1)不斷演變的環境及氣候監管規定及(2)客戶偏好的轉變可能導致負面財務影響，如增加我們的環境合規成本和由於對我們產品的需求減少而導致收益減少，因此，我們已採納一系列措施，盡量降低環境污染及不符合適用環境法律法規的風險。有關詳情請參閱本節「環境及資源管理」分節。

就物理風險(例如極端天氣事件增加或會令正常業務營運中斷、破壞機器及設備或切斷供應鏈)而言，本集團已實施多項緊急應對機制，並已針對天然災害投購充足保險，以避免潛在損失。詳情請參閱「業務－保險」。

客戶數據私隱管理

維護客戶資料(例如其產品設計、與本集團的交易記錄及其員工聯絡資料)保密為我們的首要任務之一。我們已實施旨在確保我們的員工正確處理客戶資料的數據保護政策。為保障客戶資

業 務

料的安全性及系統的數據完整性，我們已採納各種嚴格的數據安全實踐及技術以保護有關數據。我們已制訂合適的專門及組織性措施以克服潛在數據安全風險。在我們所作的努力中，我們採取下列措施以確保我們的數據安全實踐為可靠且超乎必要的範圍。

- 數據加密。我們加密我們的數據以保護我們的業務運營產生的數據免被攔截及／或篡改。
- 數據系統升級。我們及時並定期更新我們的操作系統，以防範網絡攻擊、黑客及其他安全攻擊。
- 限制資料存取。基於整體資訊科技基礎設施及對查閱資料的限制，我們的員工只能在獲得適當授權的情況下查閱資料。
- 資料備份。為保障我們客戶信息的安全及我們系統的數據完整性，數據受定期備份的保護。

業 務

社會事宜

我們已採納有關薪酬及解僱、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的政策。更多詳情請參閱「業務-員工」。我們致力於建立多元化及共融的工作環境。下表載列於二零二二年六月三十日我們在中國按性別及年齡劃分的員工結構：

	員工人數	佔總人數百分比
按性別		
男性	221	53
女性	193	47
	<u>414</u>	<u>100</u>
按年齡組別		
30歲或以下	88	21
31至40歲	144	35
41至50歲	133	32
51歲或以上	49	12
	<u>414</u>	<u>100</u>

業 務

有關我們已識別的其他關鍵ESG範疇(即產品質素及產品退貨、職業健康及工作安全以及保護知識產權)的討論，請參閱「業務－質量控制」、「業務－客戶－產品缺陷及更換」、「業務－健康及職業安全」及「業務－知識產權」。

總括而言，我們非常重視ESG管理，亦明白有效及高效率的ESG管理需要持續努力及投資以及不同部門及附屬公司的貢獻。我們致力於進一步改進環境及社會數據指標。此外，我們計劃於二零二三年上半年根據GEM上市規則附錄二十的標準編製及發佈首份ESG報告，當中將包括更多定性及定量ESG資料及分析。

法律合規、牌照及許可

法律合規

於往績記錄期間，本集團並無為員工就社會保險計劃及住房公積金付款或作出全額供款。進一步詳情載於下文。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並不知悉有關適用法律及規例可能對我們的業務、前景、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何重大不合規事件或系統性不合規事件。

業 務

A. 涉及中國附屬公司的不合規事件

序號	不合規事件	不合規事件的主要原因	法律後果、潛在的最高罰款和其他金融負債	已採取/將予採取的糾正行動	防止不合規事件再次發生的內部控制措施
1.	<p>於往續記錄期間，本集團於中國的附屬公司未能按中國法律規定為其僱員繳付或足額繳付社會保險計劃及住房公積金。</p>	<p>發生不合規事件主要是由於(i)我們的部分僱員要求我們不為其支付或全額繳納社會保險；及(ii)我們提供住房補貼或宿舍，而非繳納住房公積金。</p>	<p>根據《中華人民共和國社會保險法》及其他相關的中國法規，對於二零一一年七月一日之後未繳納的社會保險費，相關政府機構可要求公司於規定時限內繳納該費用，同時對逾期未繳納的公司處以額外罰款，罰款標準為自該社會保險費逾期之日起計算的每日0.05%。倘未於規定期限內繳納社會保險，本集團可被處以供款不足金額一至三倍的罰款。根據《住房公積金管理條例》規定，有關住房公積金管理中心的公司可要求未按要求繳納住房公積金的公司在規定期限內繳納；為此，住房公積金管理中心可申請法院命令強制執行該供款。</p>	<p>經董事評估，截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩年，我們少付社會保險供款及住房公積金供款的金額分別約為864,000港元及2,464,000港元。因此，我們與申報會計師同意於我們的財務報表中分別就截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日兩個年度的社會保險計劃及住房公積金供款的估計不足數額計提864,000港元及2,464,000港元的撥備。我們承諾，一旦接獲地方政府通知，我們將盡快補足社會保險及住房公積金供款補繳過往不足數額。如有關部門要求我們支付過往拖欠的社會保險及住房公積金繳款，或任何滞纳金或罰款，而規定不足以支付，湯先生已承諾全額賠償我們的任何差額。</p>	<p>為預防有關不合規事件再次發生：(i)我們已就社會保險及住房公積金供款採納相關內部控制政策；(ii)我們已指定人力資源部門人員密切監察持續遵守有關社會保險及住房公積金供款法規的情況，並監察實施情況；(iii)人力資源部門負責監察向社會保險及住房公積金供款的狀況，以確保我們已根據適用法律法規及時為僱員作出該等供款。供款記錄由人力資源部門妥善存檔及保留；(iv)我們將就相關法律法規的最新進展為董事及高級管理層安排定期培訓；及(v)我們將繼續就僱員社會保險及住房公積金供款是否符合適用中國法律法規訂明的標準與僱員溝通。</p>
				<p>根據我們的中國法律顧問提供確認的主管機構東莞市人力資源和社會保障局(「該局」)進行的諮詢，根據該局於二零二零年四月十四日所發出的確認，本集團於二零二零年一月一日至二零二零年三月三十一日期間未因少繳社會保險計劃及住房公積金供款而受到任何處罰。我們的中國法律顧問亦取得東莞市社會信用體系建設統籌協調小組辦公室日期為二零二零年四月十四日的確認二零一七年四月二日至二零二零年四月二日期間，本集團未因少繳社會保險及住房公積金而受到處罰。</p>	<p>以下載列加強措施：(i)我們要求僱員於簽署僱員合約後30日內申請社會保險及住房公積金供款；(ii)向社會保險/住房公積金付款前，我們會每月提交相關申請，供人力資源部門及財務部門批准，以確保供款金額符合法律規定；(iii)我們會密切監察持續遵守社會保險及住房公積金供款相關法規的情況，並監察實施情況；(iv)我們會安排法律部門為董事及高級管理層提供相關法律法規最新進展的年度培訓；(v)我們會繼續就僱員社會保險及住房公積金供款是否符合適用中國法律法規訂明的標準與僱員溝通；及(vi)我們會監察規則及法規(包括社會保險及住房公積金供款規定)的任何更新或變動，並採取必要行動遵守法律規定。我們會於必要時諮詢相關外聘專業人士。</p>
					<p>為重新遵守規定，及根據我們的中國法律顧問於編纂過程中的建議，我們立即著手糾正該不合規行為，自二零二零年一月一日起全額繳納社會保險及住房公積金。我們的董事並無直接或故意參與不合規行為。根據我們的中國法律顧問與該局的諮詢，我們獲悉，我們並未因違反相關法例或法規而被該局或其下屬單位調查、處罰或責令支付少繳社會保險計劃，亦不存在未決或潛在的住房公積金糾紛。我們的中國法律顧問認為，根據上述諮詢，我們就該不合規事件受到任何行政處罰的風險極微。基於上述情況，我們的董事認為，該不合規事件不會對我們的財務狀況及業務營運造成任何重大不利影響。</p>

業 務

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，並無任何針對本集團或附屬公司現任董事提出的任何起訴，彼等任何一方亦無就上文披露的不合規事件被處以任何罰款。根據彌償契據，控股股東已不可撤銷地承諾，共同及個別地就本集團因上述不合規事件導致或與之相關的任何損失及／或罰款而直接或間接蒙受盡產生的所有索賠、訴訟、要求、法律程序、判決、損失、責任、損害賠償、成本、收費、費用、開支、罰款及罰金為本集團提供全面彌償。有關控股股東提供彌償的進一步詳情，請參閱本文件附錄四「E.其他資料－稅項及其他彌償保證」一段。

經考慮本節所披露導致不合規事件的事實及情況，以及本集團減少不合規事件再次發生的機會的加強內部控制措施後，董事認為及獨家保薦人同意，(i)我們已根據GEM上市規則的規定訂有充分有效的內部控制程序；及(ii)過往的不合規事件不會影響董事根據GEM上市規則第5.01及5.02條擔任上市發行人董事的合適性，以及本公司根據GEM上市規則第11.06條上市的合適性。

牌照及許可

於最後實際可行日期，本集團已取得以下牌照：

牌照	持有人	發出機構	涵蓋的工作類		
			別	發出日期	屆滿日期
《海關進出口貨物收發貨人備案回執》	優博電子包裝	中國東莞海關	進出口貨物收發	二零二一年八月十三日	不適用
《海關進出口貨物收貨人備案回執》	優博實業	中國東莞海關	進出口貨物收發	二零一九年十二月二十五日	不適用

業 務

董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已取得進行業務營運所有重大方面的所有必要牌照、批准、許可及登記。

訴訟及潛在索償

我們於日常業務過程中或會不時涉及法律、仲裁或行政程序。於最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對財務狀況或營運業績造成重大不利影響的實際或未決法律或仲裁程序。具體而言，我們並無涉及第三方已向本集團提出或知會本集團並針對我們(反之亦然)的任何重大索償或行政處分。

於最後實際可行日期，董事並不知悉任何正在進行或未決並針對本集團的訴訟、仲裁請求，而可能會對我們的財務狀況或營運業績產生重大不利影響。

風險管理及內部控制

風險管理

董事會的責任為於任何時候監察並確保我們維持穩健及有效的內部控制及風險管理系統，以保障股東的投資及我們的資產。

在我們的營運過程中，我們面臨各種風險，有關詳情載於本文件「風險因素」一節。鑑於本集團面臨潛在風險，在董事會監察及管理與我們的業務營運相關的整體風險同時，我們亦設立審核委員會，以審查及監督本集團的財務報告程序、風險管理及內部控制系統。有關審核委員會的職權範圍及責任的詳細描述，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事委員會－審核委員會」一節。

此外，我們已制定及採納各種有關我們業務風險管理的措施及程序，例如(i)對整體業務運營進行風險評估及監控；(ii)財務報告及披露；(iii)生產；(iv)現金管理及庫務；及(v)遵守適用的稅收、環境保護及財產使用的法律法規的程序。管理層亦不時定期監察實施該等措施及程序的情況，以確保風險控制系統穩健有效。

業 務

內部控制

於籌備[編纂]時，我們已委聘一名外部內部監控顧問於二零二一年十一月二十九日至二零二一年十二月二十四日對我們的內部監控系統進行評估，並於二零二二年二月二十二日至二零二二年四月五日進行跟進審查，並審查我們的業務運營管理，包括庫存、財務、人力資源、資訊科技一般控制，以及審查及跟進我們加強的內部控制措施的有效性。例如，我們已制定新的員工手冊，以確保在不同方面的有效一致做法，包括但不限於招聘及解僱、試用期以及預付現金及付款。我們亦已制定涵蓋融資管理的書面政策及程序。

因此，我們針對該等發現及建議採取整改及改進措施。我們的內部監控顧問亦已完成程序以跟進我們就內部監控系統所採取的行動，並確認我們已修改及新的內部監控程序均已圓滿執行。基於上述，董事認為，我們已採取合理步驟建立內部監控系統及程序，以加強我們對工作及管理層面的監控。基於以上所述，董事認為，我們已採取合理步驟建立內部監控系統及程序，以加強我們對工作及管理層面的監控。

本集團已採取以下措施，以確保[編纂]後持續遵守上市規則：

- 董事於二零二二年三月二十九日出席了由我們的香港法律顧問舉辦的培訓課程，內容有關股份在聯交所上市的公司董事的持續義務及職責。
- 我們已同意委聘西證(香港)融資有限公司為我們的[編纂]合規顧問，以就與GEM上市規則及／或適用於本公司的其他相關法律法規有關的合規事宜向董事會提供建議及協助。
- 我們已成立審核委員會，由全體獨立非執行董事劉勁柏先生、馬淑蓮女士及王樂民先生組成。審核委員會已採納清楚列明其職責及責任的職權範圍，其中包括監督本集團的內部監控程序及會計及財務報告事宜，並確保遵守相關法律及法規。有關獨立非執行董事的履歷詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。
- 在我們認為必要和適當時，我們將就與內部控制及法律合規有關的事宜尋求獨立內部控制顧問、外部法律顧問及／或其他適當的獨立專業顧問的專業意見及協助。

董事確認，本集團實施的內部監控措施屬充分，並能有效確保本集團的內部監控制度健全。